

業務

概覽

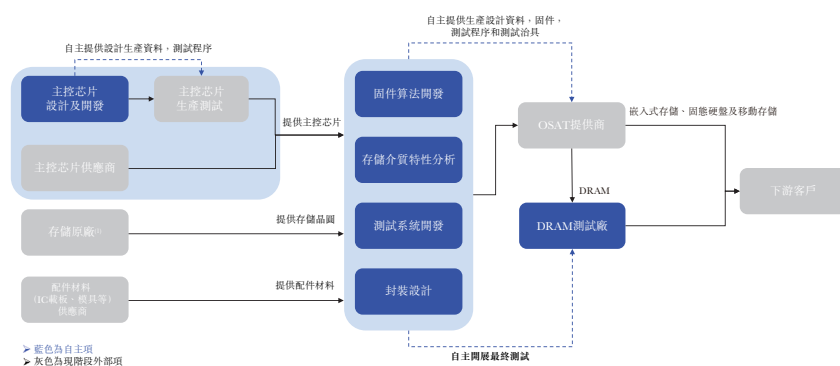
我們是誰

根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，我們是全球第五大、中國第二大獨立存儲器廠商。截至2026年4月30日止四個月，我們錄得收入超過10億美元，期內利潤超過5億美元，反映期內業務規模及盈利能力持續增長。我們搭建了覆蓋四大核心技術的平台，包括(i)主控芯片設計與開發，(ii)固件算法開發，(iii)測試系統開發及(iv)存儲介質特性分析。我們通過該平台提供存儲產品。我們的存儲產品主要包括(i)嵌入式存儲、(ii)固態硬盤、(iii)DRAM及(iv)移動存儲。

發展迅速：我們成立於2018年12月。於2023年，我們的收入已超過10億美元。我們由2023年的淨虧損人民幣117.5百萬元扭虧為盈，2024年淨利潤為人民幣482.9百萬元，2025年淨利潤為人民幣1,363.9百萬元，由2024年至2025年增加182.5%，並進一步錄得淨利潤由截至2025年4月30日止四個月的人民幣123.1百萬元增加3,020.8%至2026年同期的人民幣3,840.6百萬元。自成立至今，我們深耕存儲產品的應用。我們與消費級應用場景領域的知名企業保持著深厚的合作關係，包括小米通訊技術有限公司（「**小米**」）、深圳傳音控股股份有限公司（「**傳音**」）、OPPO廣東移動通信有限公司（「**OPPO**」）、維沃移動通信有限公司（「**Vivo**」）、王牌通訊（香港）有限公司（「**TCL**」）及上海小度技術有限公司（「**小度**」）等。我們已在消費級應用場景中建立競爭優勢，包括(i)對客戶需求的洞察、(ii)將客戶需求轉化為產品特性的技術專長及(iii)將新存儲產品商業化的能力。這些競爭優勢使我們能夠在多元化應用場景中複製我們的成功。我們於2023年開始為車規級應用場景提供存儲產品，並成功進入Tier 1供應商供應鏈，該等供應商為直接向汽車製造商提供零部件、模組、系統或解決方案的供應商，並須符合該等汽車製造商的相關資格認證、驗證、質量控制及交付要求。我們已開始量產應用於企業級應用場景的存儲產品。

AI機遇：AI技術正邁入加速應用的關鍵階段。2025年全球產生的數據總量已達200ZB。數據量的激增是推動半導體市場快速增長的關鍵因素。AI技術的核心基礎設施包括(i)存力、(ii)算力及(iii)運力。存力是基礎，承擔AI訓練所需海量數據的管理、存儲與調度。存儲產品作為存力的核心支柱，在決定AI技術的部署效率、運行穩定性及規模化發展方面發揮著決定性作用。憑借現有的客戶網絡，我們將在AI時代持續拓展我們的存儲產品的應用場景，並連接更多客戶。

下圖說明我們於存儲產品產業鏈中的角色：



業 務

我們主要作為一家獨立存儲器廠商，在存儲產品價值鏈的中游環節開展經營。我們從供應鏈合作夥伴採購存儲晶圓等主要上游原材料（以及如適用，採購主控芯片及其他元件），並專注於產品定義、（自有存儲產品的）主控芯片與固件開發，以及產品工程和質量管理。我們不經營存儲晶圓製造設施、晶圓製造商或OSAT設施。我們自主設計的主控芯片的晶圓加工由晶圓製造商合作夥伴完成。存儲產品的封裝、組裝、測試，以及如適用的SMT及相關測試服務，主要由OSAT合作夥伴完成。相比之下，我們的測試系統開發是指我們內部驗證及質量管理的內部能力，而非提供第三方測試服務。

以下為我們在產業鏈中所參與的主要環節：

- **存儲技術平台：**

- **主控芯片設計與開發。**我們已具備自主設計與開發主控芯片的能力。通過專有芯片架構與電路設計，我們將關鍵通用固件算法轉化為硬件加速原生功能，以達到高讀寫速度與低功耗。同時，我們對芯片尺寸進行優化，在有限佔位面積內實現性能與成本的有效平衡。我們自主設計與開發的主控芯片構成了堅實的技術壁壘，是我們在市場競爭中的關鍵優勢來源。我們的主控芯片設計及開發主要供自身存儲產品使用，該等主控芯片的晶圓加工／製造委外予晶圓製造商合作夥伴。

我們從商業化角度規劃主控芯片的設計與研發工作，以存儲產品市場的主流需求為導向。截至最後實際可行日期，除已進入量產階段的主控芯片外，我們自主設計與開發的主控芯片有八款型號，包括分處送樣、流片、後端設計及前端設計等不同研發階段，形成了兼具高效率、產品組合多元化及研發管線層級化特點的主控芯片研發體系。具體而言：

- **送樣階段：**適用於(i) UFS2.2及(ii) eMMC5.1的主控芯片；
- **流片階段：**適用於(i) USB3.2、(ii) UFS4.1及(iii) PCIe4.0 SSD的主控芯片；
- **後端設計階段：**適用於(i) PCIe5.0 SSD及(ii)低功耗UFS2.2的主控芯片；及
- **前端設計階段：**適用於UFS5.0的主控芯片。

隨著自主設計與開發的主控芯片在存儲產品中的應用進一步深化，我們預計相關研發能力將進一步鞏固我們的競爭優勢，降低銷售成本並提升毛利率。

- **固件算法開發。**我們自主開發核心固件算法，包括先進的閃存轉換層、垃圾回收機制、磨損均衡算法及動態低功耗平衡算法。這些技術不僅將讀寫速度提升至行業領先水平，還大幅降低了延遲與動態功耗。

業 務

- **測試系統開發。**我們構建了覆蓋芯片級至系統級的綜合內部測試系統，用於產品開發、驗證及質量管理，包括支持及管理我們的委外製造及OSAT合作夥伴的封裝及測試流程。該系統可有效識別並解決設計缺陷及潛在故障，顯著提升產品質量與可靠性。
- **存儲介質特性分析。**針對源自不同供應商的存儲介質(如NAND Flash)，我們開展底層深度特性分析，精準分析在不同工藝節點、電壓及溫度下的電學特性與衰減規律。該研究同時為固件算法開發及主控芯片設計與開發奠定技術基礎。
- **存儲產品**(我們的存儲器產品主要透過將晶圓加工委外予第三方晶圓製造商，並將組裝、封裝及測試外包予第三方OSAT供應商而生產。)：
 - **嵌入式存儲：**嵌入式存儲為我們的核心產品。嵌入式存儲指集成於電子產品主系統的存儲模塊。憑藉多年技術積累，我們構建了多元化嵌入式存儲產品線，涵蓋eMMC、UFS、ePOP及uMCP。我們的嵌入式存儲產品可應用於智能手機、平板電腦、AI攝像頭、無人機、AI眼鏡、智能手錶、相機、車載中控系統、智能座艙系統及T-Box等領域。
 - **固態硬盤：**固態硬盤指安裝於電腦或服務器內的內置存儲組件，相比傳統硬盤驅動器具備更優的性能及可靠性。在SATA及PCIe產品線中，我們支持多代接口規格，如SATA 3.0、PCIe3.0及PCIe4.0。我們的固態硬盤應用場景覆蓋範圍正由消費級拓展至車規級與企業級。我們的固態硬盤產品可應用於個人電腦、數據中心及車載中控系統等領域。
 - **DRAM：**DRAM指一種易失性存儲器，用於電腦及其他設備存儲正在使用或處理的數據，需定期刷新以維持存儲信息。我們的DRAM產品組合涵蓋多種產品類別，包括DDR4及DDR5、LPDDR4X及LPDDR5X低功耗存儲器，以及DDR4及DDR5 DRAM模組。我們的DRAM產品可應用於智能手機及個人電腦等領域。
 - **移動存儲：**移動存儲指便攜式存儲設備。我們的移動存儲產品包括U盤及 microSD 存儲卡。

我們的客戶基礎與供應鏈

客戶結構：我們的客戶基礎涵蓋業內頭部企業。我們的客戶佈局精準聚焦於存儲產品主要應用領域，涵蓋智能手機、平板電腦、個人電腦、智能影像設備及車載中控系統等。這些領域既是數字經濟發展的核心載體，也是AI驅動需求爆發的重點領域。這類客戶不僅訂單規模大、需求穩定，更具備持續的技術創新需求，推動我們的產品不斷進步與迭代，以滿足客戶不斷變化的多元需求。

業 務

客戶合作：我們注重與頭部客戶的深度合作。我們憑借在關鍵技術上的積累，與客戶合作開展技術需求對接與聯合驗證，可根據不同應用場景的特定需求，在存儲產品的容量、速度、功耗等維度進行針對性優化。例如，我們與智能手機供應商合作搭建聯合驗證實驗室，這使我們能夠提前捕捉存儲產品行業的技術發展趨勢。

供應鏈支撐：我們構建了全球化的供應鏈系統。我們與供應鏈上的行業龍頭企業建立了深度合作，包括(i)原材料供應方面的全球領先存儲原廠及主控供應商，(ii)晶圓加工方面的聯芯集成電路製造(廈門)有限公司(「**聯芯集成**」)等晶圓製造商及(iii)(a)封裝測試，及(b)SMT與測試方面的華泰電子股份有限公司(「**華泰電子**」)及沛頓科技(深圳)有限公司(「**沛頓科技**」)等OSAT供應商。該等合作增強我們提前鎖定產能的能力，確保履行大規模訂單所需的可擴展性與可靠性。這一供應鏈基礎增強我們整合資源的能力，並支持我們生態系統的可持續增長。

我們採用輕資產模式運營，主要將晶圓加工、封裝及測試委外予第三方晶圓製造商及OSAT服務供應商，而不像某些同業(即獨立存儲器廠商)那樣對內部封裝及測試設施進行大量資本投資。存儲產品的封裝及測試由相對成熟的產業鏈支持，且市場上有眾多晶圓製造商及OSAT服務供應商，這使我們在選擇服務供應商方面具有靈活性，且截至最後實際可行日期，我們在與該等合作夥伴的合作中並未遇到任何重大產能限制。我們相信此模式在商業及戰略上均具裨益，因為它能減少前期資本開支及固定成本，使我們能夠利用成熟的晶圓製造商及OSAT合作夥伴的技術、規模及製造能力，提升不同產品類別及客戶要求下的生產靈活性及可擴展性，並使我們能夠將資源集中於主控芯片設計與開發、固件算法開發、測試系統開發及存儲介質特性分析等核心能力。同時，與自行進行封裝及測試的同業相比，我們的輕資產模式可能會使我們對若干封裝及測試流程的直接控制較少，並且我們可能更容易受到第三方產能分配、交貨週期波動、質量控制協調及供應鏈中斷的影響。

我們的市場機遇

數據密集型應用(包括AI相關應用)推動的市場需求

AI相關及其他數據密集型應用預計將推動對具有更高容量、性能及可靠性要求的存儲產品的需求。根據弗若斯特沙利文的資料，全球存儲產品市場預計由2026年的3,775億美元增長至2030年的7,238億美元，年複合增長率為17.7%。我們相信，儘管存儲產品的需求仍然受到行業週期性、供需狀況、產品採用程度和其他市場因素的影響，但該等市場趨勢可能為存儲產品企業創造機遇。

- **消費級應用場景：**消費級應用的AI賦能升級正日益貼合以用戶為核心的需求。終端廠商正從為單一設備開發AI功能，轉向構建以本地化邊緣計算(指在終端設備或鄰近網路本地處理及分析數據，而非主要將數據發送至遠端雲服務器進行處理)為核心的全面硬件生態體系，這可降低延遲、提升反應速度，並在網路連接受限時支持若干功能。這一轉型涵蓋AI手機、AI平板電腦及AI個人電腦的快速迭代，以及智能影像和可穿戴

業 務

設備中AI功能的拓展。此類消費級應用對存儲產品的性能提出愈發嚴苛的要求，包括更快的讀寫速度、更高的容量、更低的延遲、緊湊的設計及更優的能效表現。消費級應用場景為2025年全球存儲產品市場中規模最大的應用場景類別。消費級應用場景的全球市場規模於2025年達874億美元，並預計於2026年至2030年期間實現進一步增長。

- **企業級應用場景：**數據中心為AI技術大規模部署的核心載體。伴隨大模型訓練、雲計算服務及行業數據的指數級增長，繼算力之後，存力已成為關鍵瓶頸，推動存儲需求實現前所未有的增長。企業級應用場景的市場規模預計將由2026年的1,042億美元增長至2030年的1,961億美元，年複合增長率達17.1%。此外，企業級應用場景為2025年全球存儲產品市場中規模第二大的應用場景類別。
- **車規級應用場景：**用於車規級場景的存儲產品需滿足嚴苛的耐溫、抗衝擊及可靠性標準，且量產環節需通過複雜的認證流程。車規級應用場景正加速向電動化、智能化及物聯網方向轉型。驅動該需求增長的核心因素包括智能座艙技術及智能駕駛技術的持續迭代升級。車規級應用場景的市場規模預計將由2026年的877億美元增長至2030年的1,795億美元，年複合增長率達19.6%。

行業週期及數據密集型應用的需求

根據弗若斯特沙利文的資料，AI相關及其他數據密集型應用的需求，加上供應結構的變化，推動了2025年若干存儲產品的價格上漲。然而，存儲產品行業歷來具有週期性，可能持續出現價格波動、庫存調整及供需失衡。概不保證該等需求增長或價格趨勢將會持續。

我們的優勢

一家領先的獨立存儲器廠商

我們的市場地位：我們成立於2018年12月。於2023年，我們的收入已超過10億美元。自成立以來不足十年的時間裡，我們在技術研發、產品創新與商業化方面不斷實現里程碑式的突破。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，我們是全球第五大、中國第二大獨立存儲器廠商，并且是少數擁有自主設計及開發主控芯片能力並完成商業化應用的中國獨立存儲器廠商之一。

四大要素：憑借我們的市場地位，我們不斷強化(i)技術創新，(ii)產品，(iii)客商生態鏈，及(iv)管理團隊等四大運營要素，進而進一步加強我們的市場地位，形成增長良性循環。技術創新奠定有競爭力的產品基礎，優質產品吸引高價值客戶，高價值客戶不僅帶來穩定訂單，更提供市場洞察與供應鏈優化，而穩健的供應鏈能夠保障產品的順利落地，資深團隊則驅動整個鏈條持續向前運轉。上述四大要素構成我們不斷自我強化的商業閉環。

業 務

獎項與榮譽：我們被認定為國家級高新技術企業、國家級專精特新「小巨人」企業、中國獨角獸企業第166名、賽迪科創獨角獸百強、2024年廣東500強企業第243位、廣東省民營企業100強第70位、深圳瞪羚獨角獸企業、2024年深圳500強企業第132位，並獲評為廣東省製造業單項冠軍企業——嵌入式存儲芯片。

持續的技術創新

研發及商業化能力：我們研發團隊具備從消費級到企業級、車規級等主要應用場景全面的產品開發能力，形成「基礎研究—產品方案—量產驗證」的完整研發流程。我們掌握了主控芯片的全棧設計研發能力，並開始將自主設計與開發的主控芯片應用於存儲產品。我們能夠為客戶提供定製化和標準化的存儲產品滿足客戶的多元化需求。我們的產品能夠實現技術的快速商業化並以反哺研發，構成良好的產研循環。

研發投入：我們持續投資於研發活動。於往績記錄期間，我們的累計研發投入已超過人民幣13億元，為我們的存儲技術平台提供支持。根據弗若斯特沙利文的資料，於往績記錄期間，我們的研發開支金額及佔比均高於存儲產品行業的平均水平。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年4月30日止四個月，我們的研發開支分別為人民幣282.6百萬元、人民幣392.2百萬元、人民幣493.2百萬元、人民幣151.4百萬元及人民幣199.6百萬元，分別佔我們同期總收入的3.2%、4.5%、4.4%、5.4%及2.5%。

研發團隊：研發團隊是我們不斷實現創新突破的關鍵力量。我們高度重視研發人員的引進、專業人才的培養和研發團隊的建設。我們的研發中心覆蓋深圳、合肥、上海、廈門及杭州等多個城市。我們的核心技術人員均深耕半導體行業。截至2026年4月30日，研發人員佔我們員工總數超過60.0%，碩士及博士人員佔研發人員總數接近一半。

研發成果：我們存儲產品的研發實力是技術護城河。截至2026年4月30日，我們在國內外擁有416項授權專利，其中包括320項發明專利。2022年，我們被廣東省科學技術廳認定為「廣東省高性能存儲控制芯片工程技術研究中心」。

性能卓越、應用場景多元的產品組合

我們的產品專為主要應用場景而設計，包括(i)消費級應用場景、(ii)企業級應用場景及(iii)車載級應用場景。我們通過精準拆解不同場景技術痛點，我們提供適用於多種應用場景的存儲產品。具體而言：

- **消費級應用場景：**我們的存儲產品覆蓋廣泛的消費級應用場景。例如，我們的嵌入式存儲產品組合涵蓋廣泛的容量等級，旨在支持多種終端場景，以迎合消費級應用場景

業 務

中AI驅動升級的不斷演變的需求。我們的eMMC、UFS、ePOP及uMCP等產品不僅覆蓋主流型號，更針對不同場景需求打造產品矩陣：

- **常規設備端：**舉例而言，我們推出的UFS2.2、eMMC5.1保障系統穩定流暢運行。在可穿戴設備領域，小尺寸、低功耗的ePOP及eMMC特規產品，高效節省PCB空間與設備功耗。
- **高端設備端：**舉例而言，我們推出的UFS3.1及UFS4.1的讀寫速度大幅提高，大幅縮短應用安裝、大型遊戲加載與4K視頻處理耗時。
- **AI應用：**舉例而言，我們推出的LPDDR5X，以8,533 Mbps高速傳輸速率與雙通道技術，為邊緣AI高性能計算注入強勁動力。面對AI手機及AI平板電腦等設備的多模態交互需求，我們的產品能高效承接數據吞吐，避免多任務切換卡頓，優化系統響應速度，全方位適配AI時代的存儲需求。
- **企業級應用場景：**舉例而言，我們正在研發的PCIe5.0 eSSD將實現性能躍升，帶寬較前代提升2倍，連續讀寫速度分別高達13GB/s與10GB/s，高度匹配AI訓練對數據傳輸帶寬的較高需求，保障數據高速、穩定、低延遲流轉；容量方面支持高達122.88TB超大擴展，可容納海量AI訓練樣本、龐大模型參數及推理過程中的中間數據，滿足企業級應用場景下對於高強度數據處理的要求。
- **車規級應用場景：**我們推出的三大車規級系列產品：eMMC、UFS、BGA固態硬盤，均通過AEC-Q100 Grade2/3嚴格認證，且遵循ISO 26262:2028 ASIL D功能安全標準。舉例而言，車規級UFS產品讀寫速率高達4,300MB/s/3,700MB/s，滿足智能駕駛場景下海量數據高速傳輸需求。目前，產品已開始在車載智能系統的關鍵場景實現應用，並與國內汽車Tier 1供應商建立穩定合作。

覆蓋行業頭部企業的客商生態鏈

我們以終端用戶需求為起點，以供應鏈資源為支撐，建立一個全鏈路的整合與協同存儲產品生態鏈。該生態鏈促進終端客戶與供應鏈合作夥伴之間的雙向賦能。

我們的客戶合作：我們在研發過程中與行業頭部客戶建立深度合作。例如，我們已與小米、傳音、OPPO、Vivo、TCL、小度及北斗智聯（江蘇）科技有限公司（「**北斗智聯科技**」）建立穩定合作。該等行業頭部企業對產品的可靠性、品質穩定性及交付及時性有較高要求。為滿足該等要求，我們組建了一支由銷售、研發及生產人員組成的專屬服務團隊。我們提供實時響應，並根據終端客戶的具體項目要求進行研發，從而與客戶建立互動、緊密及互利共贏的合作關係。

我們的供應鏈體系：我們構建了國際化的供應鏈系統。我們與供應鏈上的行業龍頭企業建立了深度合作，包括(i)原材料供應方面的全球領先存儲原廠，(ii)晶圓加工方面的聯芯集成等晶

業 務

圓製造商及(iii)(a)封裝測試和(b)SMT與測試方面的OSE、沛頓科技、華天科技等OSAT供應商。該等合作增強我們確保產能的能力，因為我們一般與晶圓製造商及OSAT服務供應商訂立為期多年的框架協議，並根據我們的生產規劃及客戶訂單安排，提前下達工單讓其安排生產計劃及加工資源。此外，我們實施供應商管理及質量控制措施(包括嚴格的資格審查、專注於交付可靠性及質量保證的定期性能審查，以及我們自行進行的產品檢驗，對於檢驗不合格產品擁有合同約定的退貨權利)，該等措施支持我們委外加工製造及封裝的可擴展性及可靠性，並協助我們履行大規模訂單。此外，我們已與多家行業領先的存儲器製造商及主控芯片供應商建立了超過三年的長期戰略合作關係。我們與該等存儲器製造商及主控芯片供應商訂立年度採購協議，並就下一代存儲介質、製程進步及架構升級等主題進行季度及月度技術交流。這一供應鏈基礎增強我們整合資源的能力，並支持我們生態鏈的可持續增長。

搭建橋樑：為確保生態鏈的高效整合，我們搭建客戶與存儲原廠技術團隊之間的橋樑，促進客戶特定需求與上游產能之間的協調一致。此舉使存儲原廠能夠開發精確滿足我們客戶需求的存儲晶圓，確保我們的存儲產品最適配下游應用場景。憑藉匯總需求的規模效應，我們可優先獲取上游製造資源，同時實現精準滿足需求與供應鏈穩定可控的雙重目標。該整合模式不僅增強了關鍵原材料供應的穩定性與連續性，亦提升了成本效益，進一步鞏固我們的競爭優勢。

經驗豐富的管理團隊

我們的領導層：我們的核心管理團隊由經驗豐富的領導層組成。他們深耕存儲產品行業，見證並深度參與了中國存儲產品行業的發展。秉持對長期增長的承諾，我們的管理團隊運用行業專業知識及戰略眼光，在業務戰略、市場拓展、產品創新、融資及產業資源整合等關鍵領域提供領導力。我們的核心管理團隊包括專注於存儲產品基礎技術的研發專家，以及在存儲產品行業擁有豐富經驗的業務領導者。這一多維度的專業知識使我們能夠熟練應對存儲產品產業鏈固有的快速技術演進及複雜挑戰。我們的管理團隊擅長在技術演進的關鍵節點識別並把握市場機會，同時通過整合技術、生產及市場運營的高度響應體系，將技術創新與市場需求無縫對接。

我們的企業文化：我們的管理團隊着力打造創新務實的企業文化，既凝聚了團隊的向心力，又為企業發展注入持續活力。穩定且架構完善的團隊可確保機構知識的無縫傳承及戰略發展的連續性，而文化根基進一步強化團隊團結與目標一致。這一歷久彌堅的文化框架，是公司在不斷演變的市場格局中保持持續增長與競爭韌性的關鍵引擎。

我們的戰略

繼續投資於技術能力及產品開發

持續投資於新一代主控芯片研發：主控芯片作為存儲產品的控制中樞，是實現技術突破的關鍵。AI應用中，主控芯片在數據讀寫速度、協議轉換及性能優化中發揮關鍵作用。我們的主

業 務

控芯片設計與開發正由消費級應用場景，拓展至車規級應用場景及企業級應用場景，助力我們的存儲產品實現應用場景的擴容。我們主控芯片的設計與開發方面的研發計劃將聚焦於(i)接口升級、(ii)製程優化及(iii)密度突破。

持續打造先進測試中心：AI時代存儲產品的複雜度將不斷提升，先進測試已成為產品質量的基石，亦是保持競爭優勢的關鍵因素。我們計劃持續深入打造先進測試中心，配置尖端測試設備及軟件系統，覆蓋晶圓與主控芯片驗證與測試關鍵環節該等措施將加強我們產品的可靠性，使我們能夠滿足客戶對產品質量、性能的嚴苛要求。

持續開發高性能存儲產品並探索前沿技術：我們計劃推出專為數據中心領域設計的TB級乃至PB級大容量存儲產品。通過持續的技術優化，我們旨在提供具備高帶寬傳輸能力的存儲產品，以滿足AI訓練時的海量數據讀寫速度的需求。我們計劃在存儲產品中融入低功耗設計，適配移動設備、物聯網終端等續航敏感場景。此外，我們計劃提升產品兼容性，以確保與不同硬件平台、操作系統的無縫對接。我們將積極探索存算一體技術，為邊緣AI推理、實時傳感器處理及其他顛覆性應用場景提供變革性解決方案。

持續開發存儲產品，拓展多元應用場景

我們已在消費級應用場景中建立競爭優勢，包括(i)對客戶需求的洞察、(ii)將客戶需求轉化為產品特徵的技術優勢及(iii)新存儲產品的商業化能力。我們將憑藉我們的競爭優勢，鞏固在消費級應用場景的市場地位，同時策略性地拓展至多元應用場景。為確保產品的可靠性及性能，我們將繼續在研發的所有階段實施嚴格的測試方案。具體而言：

- **消費級應用場景：**我們將緊跟AI時代下消費級應用場景不斷演變的需求，推動持續創新與功能升級以深化客戶合作並拓展市場機遇。例如：
 - **客戶合作：**我們計劃緊跟AI手機及AI電腦的迅速迭代週期，強化與領先製造商的合作關係。透過由傳統供應商角色轉型為戰略夥伴，我們將深度參與產品研發前期環節以提供滿足不同客戶需求的高度定制化存儲產品。
 - **產品開發：**透過持續的研發投資，我們致力於開發體積更精巧、讀寫速度更高的存儲產品，滿足對便攜式、高清化數據存儲產品日益增長的需求。
- **企業級應用場景：**我們計劃通過與行業領先客戶合作，提升我們在企業級應用場景的影響力。我們已開始量產用於企業級應用場景存儲產品。例如：

業 務

- **客戶合作：**我們致力於與服務器供應商、雲計算供應商及電信運營商建立深度合作，優先與行業領先企業締結戰略合作夥伴關係，加速市場滲透。
- **產品開發：**我們將持續提供適配AI服務器、邊緣計算節點的企業級存儲產品，滿足大量數據的高效存儲與快速調用需求，同時強化數據安全防護功能，保障AI訓練數據、企業核心數據的可靠性與保護。
- **車規級應用場景：**我們將全面覆蓋多元客戶需求，聚焦車規級應用場景的核心領域，主要包括(i)車載中控系統及(ii)智能座艙系統。例如：
 - **客戶合作：**我們計劃深化我們與主流車企及Tier 1供應商的關係。我們計劃建立全週期服務響應機制這將使我們能夠積極參與客戶產品研發，逐步提升在頭部客戶供應鏈中的份額。
 - **產品開發：**我們計劃進一步開發滿足車載級應用場景中嚴苛環境及性能要求的存儲產品，並透過擴充產品組合至涵蓋多協議、大容量存儲產品的方式來實現。

加強全球化戰略佈局

我們將持續構建「開放、合作、共贏」的全球生態網絡。我們將持續配合客戶，聚焦全球前沿領域與高潛力賽道，提升產品在海外的曝光度與客戶導入效率，通過持續的海外市場開拓與客戶培育，逐步提升海外業務收入佔比，形成「國內市場穩固、海外市場增長」的雙輪驅動格局。

為匹配全球化業務推進，我們將搭建更高效協同的企業架構，主要包括(i)按照市場需求設立核心區域業務團隊，實現市場需求的就近響應；及(ii)組建跨部門全球支持團隊，整合研發、供應鏈人員，以滿足我們海外客戶的需求。此外，我們旨在提升海外訂單的及時履約能力，同時實現全球市場拓展與供應鏈穩定的雙目標落地。

構建多層次人才發展體系

我們將人才梯隊建設置於我們的戰略佈局的核心位置。秉持價值創造的原則，我們致力於建立一個「引進、培養、選拔、留存」維度構建全週期人才發展體系。具體而言：

- **人才引進：**我們將持續面向全球拓寬招聘視野，重點吸納芯片設計、先進封裝測試、AI應用等專業領域的高精尖人才。此外，我們旨在吸引具備熟悉國際市場規則、擁有跨行業資源整合能力的複合型人才。

業 務

- **人才培養：**我們將持續實施培訓政策，致力促進員工專業成長與長期發展。我們計劃持續發展多層次、針對崗位的技能提升框架，該框架將專為滿足不同層級及部門員工的獨特需求而設計。
- **人才選拔：**我們將持續優化人才結構。通過識別和晉升表現優異的員工及新興人才，我們將加強我們的核心骨幹團隊。定期、基於績效的考評將確保選拔和獎勵集中於展現卓越能力及潛力的員工。
- **人才留存：**我們將通過具備市場競爭力的薪酬福利體系，精準匹配人才價值與回報，同時推出覆蓋核心骨幹的長期股權激勵計劃，讓人才與公司形成深度綁定的利益共同體。此舉有助加強我們留住頂尖人才的能力，並切實築牢公司的人才護城河。

我們的產品

概述

以下是我們的產品組合圖片：



業 務

下表載列我們於往績記錄期間的產品詳情，其主要功能為數據存儲。

產品類別	領域	主要產品	主要性能指標	典型應用場景	開發狀態	目標客戶	每件價格區間 (人民幣元)	說明性示例
嵌入式存儲	消費級	• eMMC	• 技術：eMMC5.1	智能手機	已商業化	智能手機製造商	31-66	eMMC產品應用於手機及電視等終端設備，主要用於操作系統安裝及數據存儲。其特點是高集成度及低成本，同時在速度方面提供相對基本的性能。
			• 容量：4GB至256GB					
			• 讀寫速度：高達320MB/s/260MB/s					
			• 工作溫度：-25℃至85℃					
		• UFS	• 技術：UFS2.2/UFS3.1/UFS4.1	智能手機及 平板電腦	已商業化	智能手機製造商及平 板電腦製造商	10-108	UFS產品應用於旗艦及高端智能手機及平板電腦，作為數據讀寫操作的內部存儲。其特點是具有卓越的讀寫性能，能夠實現更快的應用程序啟動及更流暢的多任務處理。
			• 容量：32GB至1TB					
			• 讀寫速度：高達4,300MB/s/3,700MB/s					
			• 工作溫度：-25℃至85℃					
		• ePOP	• 技術：ePOP5X	智能手錶及 AI眼鏡	開發中	可穿戴設備 製造商	不適用	ePOP產品應用於可穿戴設備，例如智能手錶及AI眼鏡。通過將存儲及內存整合於堆疊封裝中，其顯著減少印刷電路板空間，非常適合內部空間極為受限的緊湊型電子設備。
			• 容量：64GB+4GB至128GB+4GB					
			• 讀寫速度：高達320MB/s/260MB/s					
			• LPDDR數據速率：高達8,533Mbps					
	車規級	• uMCP	• 技術：uMCP4X	智能手機及 平板電腦	已商業化	模組製造商	36-295	uMCP產品應用於中高端智能手機。通過將UFS快閃存儲及LPDDR內存集成於單一封裝內，其能減小佔用面積，並為電池或攝像頭模組等元件騰出空間，同時保持快速的讀寫性能。
			• 容量：64GB+4GB至512GB+16GB					
			• 讀寫速度：高達1,020MB/s/880MB/s					
			• LPDDR數據速率：高達4,266Mbps					
		• eMMC	• 技術：eMMC5.1	智能座艙系統、 車載中控系統及 T-BOX	已商業化	Tier 1供應商及汽車製 造商	22-160	車規級eMMC應用於車輛儀表板、車載導航系統及行車記錄儀等場景，主要用於存儲地圖數據、系統固件及其他信息。其特點是相比消費級產品，對耐溫性及耐久性有更嚴格的要求，確保車輛運行期間的穩定可靠性能。
			• 容量：8GB至256GB					
			• 讀寫速度：高達320MB/s/260MB/s					
			• 工作溫度：-40℃至105℃					
		• UFS	• 技術：UFS2.1/UFS3.1/UFS4.1	智能座艙系統及 車載中控系統	已商業化	Tier 1供應商及汽車製 造商	65-103	車規級UFS應用於智能座艙系統及車載中控系統等場景，主要用於大量傳感器數據及地圖信息的高速讀寫，其特點是讀寫性能快速，能夠滿足車輛嚴格的實時數據處理要求。
			• 容量：64GB至512GB					
			• 讀寫速度：高達4,300MB/s/3,700MB/s					
			• 工作溫度：-40℃至105℃					

業 務

產品類別	領域	主要產品	主要性能指標	典型應用場景	開發狀態	目標客戶	每件價格區間 (人民幣元)	說明性示例
固態硬盤	消費級	• SATA固態硬盤	• 技術：SATA3.0 • 容量：128GB至16TB • 讀寫速度：高達540MB/s/500MB/s • 工作溫度：0℃至70℃	個人電腦及 平板電腦	已商業化	電腦製造商及平板電腦製造商	47-4,392	SATA固態硬盤應用於個人電腦及平板電腦，作為系統驅動或存儲驅動。與傳統硬盤驅動器相比，其讀寫速度顯著提升，能夠實現更快的開機時間及更迅速的應用程序加載。
		• PCIe固態硬盤	• 技術：PCIe3.0/PCIe4.0 • 容量：128GB至4TB • 讀寫速度：高達7,400MB/s/6,500MB/s • 工作溫度：0℃至70℃	個人電腦及 平板電腦	已商業化	電腦製造商及平板電腦製造商	63-3,239	PCIe固態硬盤應用於高性能個人電腦及平板電腦等場景，借助更高速的接口，其適用於大型遊戲及視頻編輯等場景。其特點是順序讀寫速度可達SATA固態硬盤的數倍，能夠實現更高效的大型文件傳輸。
		• 便攜式固態硬盤	• 技術：USB3.2 • 容量：128GB至2TB • 讀寫速度：高達2,000MB/s/2,000MB/s • 工作溫度：0℃至70℃	個人電腦及 平板電腦	已商業化	便攜式固態硬盤品牌製造商	78-541	便攜式固態硬盤應用於個人數據備份、跨設備文件傳輸以及智能手機和電腦的外部存儲。其特點是小巧的外形及通過USB接口實現即插即用功能，在高速讀寫性能與便攜性之間取得平衡，方便出行時隨時存取重要數據。
		• PCIe5.0企業級固態硬盤	• 技術：PCIe5.0eSSD • 容量：3.84TB至122.88TB • 讀寫速度：高達13GB/s/10GB/s • 工作溫度：0℃至77℃	數據中心	部分容量規格產品已商業化	互聯網公司、雲服務供應商及AI原生企業	18,881-35,008	企業級PCIe固態硬盤應用於數據中心及AI服務器等場景，主要用於處理高併發讀寫操作及數據庫工作負載。其特點是在長時間持續運行下性能穩定，並具備斷電保護等功能。
		• 車規級BGA固態硬盤	• 技術：BGA SSD PCIe4.0 • 容量：256GB至1TB • 讀寫速度：高達3,700MB/s/2,900MB/s • 工作溫度：-40℃至105℃	車載中控系統	已商業化	Tier 1供應商及汽車製造商	251-1,247	車規級BGA固態硬盤應用於智能汽車（包括座艙及駕駛系統）。其採用芯片級封裝並直接焊接於主板上，外型小巧且抗震能力強，能在長時間車輛震動及寬溫下穩定運行。
		• LPDDR	• 技術：LPDDR4X/LPDDR5X • 容量：512MB至18GB • 數據速率：高達8,533Mbps • 工作溫度：-25℃至85℃	智能手機	已商業化	智能手機製造商	5-323	LPDDR產品應用於智能手機及平板電腦等移動裝置，作為系統存儲，用於暫時存儲正在運行的應用程序數據。其特點是低功耗及低電壓，有助於延長電池續航力。
		• DDR	• 技術：DDR3/DDR4/DDR5 • 容量：256MB至3GB • 數據速率：高達6,400Mbps • 工作溫度：0℃至85℃	個人電腦	已商業化	電腦製造商	5-63	DDR產品應用於桌面電腦及標準筆記本電腦，作為安裝於主板插槽內的存儲模組，用於與CPU進行快速數據交換。其特點是容量配置靈活及性能穩定，是電腦存儲的常見形式。
		DRAM						

業 務

產品類別	領域	主要產品	主要性能指標	典型應用場景	開發狀態	目標客戶	每件價格區間 (人民幣元)	說明性示例
移動存儲	企業級	• DRAM 模組	• 技術：DDR3/DDR4/DDR5/DRAM 模組 • 容量：2GB 至 64GB • 數據速率：高達 6400Mbps • 工作溫度：0℃ 至 70℃	個人電腦	已商業化	電腦製造商	14-925	DRAM 模組通常用作筆記本電腦、桌面電腦及服務器的存儲模組。通過標準化接口安裝於設備中，用於暫時存儲 CPU 正在處理的數據。其特點是具有可升級性及可更換性。
		• DRAM 模組 + RDIMM	• 技術：DDR4/DDR5/DRAM 模組 • 容量：16GB 至 96GB • 數據速率：高達 5600Mbps • 工作溫度：0℃ 至 95℃	服務器及工作站	部分容量規格產品已商業化	服務器製造商、互聯網公司、AI 公司及數據中心運營商	249-3,250	RDIMM 模組專為高性能計算場景而開發，包括企業服務器、數據中心、HPC 及 AI 應用。該等模組集成 ECC 功能，旨在滿足多個系統任務並行處理的需求。憑藉高可靠性及穩定性，其能有效支持服務器在高負載環境下運行。
	消費級	• U 盤	• 技術：USB2.0/USB3.0 • 容量：1GB 至 1TB • 讀寫速度：高達 220MB/s/130MB/s • 工作溫度：0℃ 至 70℃	個人電腦及服務器	已商業化	監控設備製造商、汽車製造商、音頻設備製造商及電腦製造商	6-134	U 盤用於臨時個人檔案存儲、文件傳輸及製作系統安裝媒體。其通過 USB 接口連接至電腦及電視等設備，特點是即插即用，外形小巧及易於使用。
		• microSD	• 技術：microSDHC/microSDXC/UHS-I/V30/A2 • 容量：2GB 至 256GB • 讀寫速度：高達 95MB/s/85MB/s • 工作溫度：0℃ 至 70℃	智能手機、相機及無人機	已商業化	智能手機製造商、運動相機製造商、汽車製造商、監控設備製造商及無人機製造商	11-73	MicroSD 卡應用於智能手機存儲擴充、運動相機、無人機及監控設備等場景。作為移動存儲介質，其用於存儲照片及視頻等文件。其特點是外形小巧，容量選項廣泛及易於更換。

業 務

以下表格載列於所示期間按產品類型劃分的收入明細（以絕對金額及佔總收入的百分比列示）：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月					
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年			
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	(未經審計)	
嵌入式存儲	3,732,376	42.5	5,687,730	65.2	5,369,884	47.8	1,333,001	47.5	5,432,943	67.8		
固態硬盤	1,932,012	22.0	776,110	8.9	963,989	8.6	290,391	10.4	335,604	4.2		
DRAM	112,087	1.3	1,062,748	12.2	2,784,062	24.8	755,854	27.0	1,088,245	13.6		
移動存儲	321,041	3.7	227,486	2.6	345,603	3.1	100,569	3.6	213,546	2.7		
存儲顆粒	2,360,469	26.9	784,166	9.0	1,719,397	15.2	298,874	10.6	927,309	11.5		
其他 ⁽¹⁾	322,714	3.6	180,172	2.1	54,641	0.5	25,821	0.9	14,628	0.2		
總計	<u>8,780,699</u>	<u>100.0</u>	<u>8,718,412</u>	<u>100.0</u>	<u>11,237,576</u>	<u>100.0</u>	<u>2,804,510</u>	<u>100.0</u>	<u>8,012,275</u>	<u>100.0</u>		

- (1) 主要包括(i)主控芯片，按獨立單元銷售，該等芯片用於標準化主機與NAND存儲介質之間的通信，主要負責邏輯到物理地址映射及根據NAND的特性優化NAND的耐久性與性能；(ii)技術服務，主要包括向客戶提供的定製固件開發服務；及(iii)服務器，主要包括高性能服務器，包括集成計算設備及TPU 2U服務器，該等服務器集成了CPU/GPU、存儲器、高速存儲、網絡接口卡、散熱及電源系統，專為高密度並行計算及大規模AI模型計算場景而設計。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們所知，我們的產品並未應用於工業應用場景。為按下游應用劃分我們的收入，我們主要根據相關產品的最終用途、產品規格、性能要求、可靠性要求及適用認證標準，將產品分為消費級、企業級及車規級應用場景。消費級應用場景指個人日常辦公、娛樂及其他一般消費用途的應用場景，在該等應用場景中，存儲產品旨在提供相對較高的讀寫速度及容量，同時保持成本效益。企業級應用場景指數據中心及關鍵業務運營的應用場景，在該等應用場景中，存儲產品旨在支持7天24小時全天候高負荷運行，並滿足對性能、可靠性及耐久性的更高要求。車規級應用場景指汽車電子應用場景，在該等應用場景中，存儲產品旨在滿足車規級可靠性及安全性要求（包括AEC-Q100等相關資格或認證），並在嚴苛的汽車運行環境中保持穩定運行。以下表格載列於所示期間按下游應用劃分的收入明細（以絕對金額及佔總收入的百分比列示）：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月					
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年			
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	(未經審計)	
消費級	8,779,065	100.0	8,707,986	99.9	11,189,030	99.6	2,787,538	99.4	7,929,849	99.0		
企業級	—	—	4,121	0.0	14,562	0.1	14,404	0.5	80,760	1.0		
車規級	1,634	0.0	6,305	0.1	33,984	0.3	2,568	0.1	1,666	0.0		
總計	<u>8,780,699</u>	<u>100.0</u>	<u>8,718,412</u>	<u>100.0</u>	<u>11,237,576</u>	<u>100.0</u>	<u>2,804,510</u>	<u>100.0</u>	<u>8,012,275</u>	<u>100.0</u>		

我們提供標準及定製化存儲產品。定製化的範圍及程度因客戶、產品類別、應用場景及技術要求而異。我們的定製化主要包括固件定製、主控芯片方案適配及模組設計。固件定製可包括客戶特定功能、基於客戶產品規格及應用要求的兼容性、性能、功耗及可靠性固件適配及優化。主控芯片方案適配可包括為我們的存儲產品選擇、匹配、適配或（如適用）開發主控芯片方

業 務

案。模組設計定製化可包括容量配置、封裝或外形尺寸、硬件電路設計、PCB佈局、元件選擇以及測試及驗證參數。定製化程度按個別情況釐定，並考慮技術可行性、客戶要求、產品開發時間表及商業化考慮因素。

以下表格載列於所示期間按下游應用劃分的毛利率明細：

	截至12月31日止年度			截至4月30日止四個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	%	%	%	%	%
				(未經審計)	
消費級.....	4.8	16.1	21.8	13.8	62.1
企業級.....	—	5.2	13.6	17.1	53.9
車規級.....	(6.9)	(4.4)	13.2	9.9	5.8

以下表格載列於往績記錄期間按下游應用劃分的產品以GB計的銷量及每GB平均售價：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)
消費級.....	37,224.0	0.24	21,076.9	0.41	34,995.6	0.32	8,106.5	0.34	14,210.0	0.56
企業級.....	—	—	0.3	12.88	1.6	9.27	1.6	9.27	5.7	14.15
車規級.....	0.7	2.26	2.8	2.26	25.8	1.31	1.2	2.10	1.4	1.16

由於2024年及2025年我們嵌入式存儲產品的平均售價受客戶供應安排影響，下表載列剔除客戶供應安排影響後嵌入式存儲產品的銷量及平均售價，以供參考。

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)	(每GB (百萬GB)	人民幣元)
嵌入式存儲.....	12,410.7	0.30	15,462.7	0.37	26,307.0	0.20	5,694.6	0.23	10,684.5	0.51
嵌入式存儲，不包括 客戶供應安排 ⁽¹⁾	12,410.7	0.30	11,190.9	0.48	8,291.2	0.47	2,759.4	0.40	2,574.7	1.75

- (1) 指不包括客戶供應安排項下產生的收入及銷量後，嵌入式存儲產品的銷量及平均售價。平均售價的計算方法為：將嵌入式存儲產品產生的收入(不包括客戶供應安排項下產生的收入)除以相應的嵌入式存儲產品銷量(不包括客戶供應安排項下的銷量)。於2024年4月之前並無客戶供應安排。此資料僅為呈列比較經營數據分析而提供。有關客戶供應安排的詳情，請參閱「—客戶供應安排」。

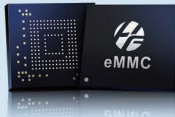
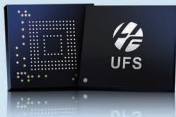
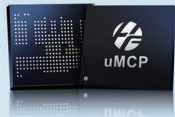
業 務

嵌入式存儲

嵌入式存儲為整合至電子產品主系統的存儲模塊。憑藉多年技術積累，我們構建了多元化嵌入式存儲產品線，以支持主流行業規格及特殊客戶需求。下表載列(i)我們的主要嵌入式存儲產品的示例圖片及特點及(ii)其部分主要應用領域的示例圖片：

消費級

我們的產品

 eMMC • 技術：eMMC5.1 • 容量：4GB至256GB • 讀寫速度：高達320MB/s/260MB/s • 工作溫度：-25°C至85°C • 商業化狀態：已商業化并持續迭代中	 UFS • 技術：UFS2.2/UFS3.1/UFS4.1 • 容量：32GB至1TB • 讀寫速度：高達4,300MB/s/3,700MB/s • 工作溫度：-25°C至85°C • 商業化狀態：已商業化并持續迭代中	 ePOP • 技術：ePOP5X • 容量：64GB+4GB 至 128GB+4GB • 讀寫速度：高達320MB/s/260MB/s • LPDDR數據傳輸速率：高達8,533Mbps • 工作溫度：-25°C至85°C • 商業化狀態：開發中	 uMCP • 技術：uMCP4X • 容量：64GB+4GB至512GB+16GB • 讀寫速度：高達1,020MB/s/880MB/s • LPDDR數據傳輸速率：高達4,266Mbps • 工作溫度：-25°C至85°C • 商業化狀態：已商業化并持續迭代中
--	---	---	---

應用領域示意



業 務

車規級

我們的產品



車規級 eMMC

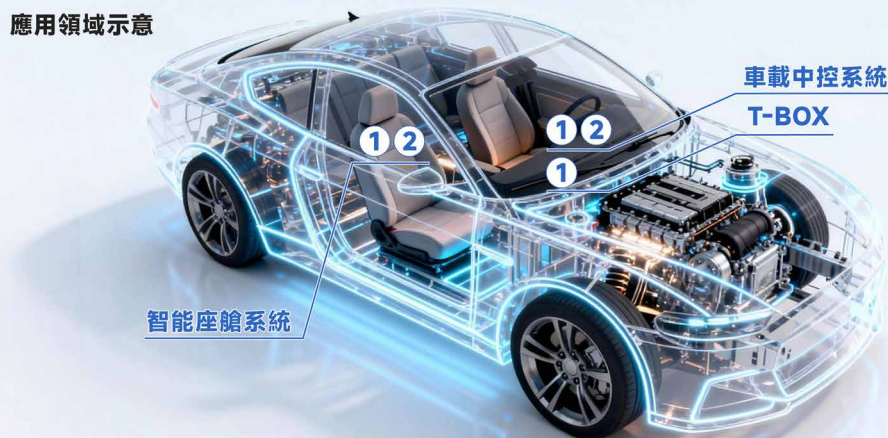
- 技術：eMMC5.1
- 容量：8GB至256GB
- 讀寫速度：高達320MB/s/260MB/s
- 工作溫度：-40°C至105°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



車規級 UFS

- 技術：UFS2.1/UFS3.1/UFS4.1
- 容量：64GB至512GB
- 讀寫速度：高達4,300MB/s/3,700MB/s
- 工作溫度：-40°C至105°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中

應用領域示意



以下是我們的嵌入式存儲在消費級及車規級應用場景中的應用：

- **消費級應用場景。**我們的嵌入式存儲可全面覆蓋消費級應用場景中的各類性能需求，使我們能夠滿足廣泛的客戶需求，並持續提升我們的客戶獲取能力。具體而言，我們的UFS3.1及UFS4.1的高速傳輸速度，支持高端設備的快速應用程式安裝、大型遊戲載入及高比特率視頻錄製和實時編輯。我們的UFS2.2及eMMC5.1則為主流機型提供穩定且具成本效益的解決方案，兼顧性能表現與可靠性。針對輕巧型及穿戴式裝置，ePOP及eMMC5.1採用了比傳統模塊小的封裝設計，使設備製造商能夠優化PCB佈局。
- **車規級應用場景。**我們的車規級eMMC及UFS產品旨在用於車規級應用場景。該等產品符合嚴格的可可靠性及安全標準，不僅通過AEC-Q100 Grade 2/3 認證，並遵守ISO 26262 ASIL B功能安全標準。車規級UFS的讀寫速度高達4,300MB/s/3,700MB/s，可滿足智能駕駛系統及高階資訊娛樂平台對高數據帶寬的需求。我們的嵌入式存儲已在智能座艙系統、車載中控系統及T-Box等大批量應用中採用。

業務

固態硬盤

固態硬盤指安裝於電腦或伺服器內的內部存儲組件，相較機械硬盤提供更佳的性能及可靠性。我們的固態硬盤產品組合支持主流行業要求及特殊客戶需求。下圖載列(i)我們的主要固態硬盤的示例圖片及特點及(ii)其部分主要應用領域的示例圖片：

消費級

我們的產品



SATA固態硬盤

- 技術：SATA3.0
- 容量：128GB至16TB
- 讀寫速度：最高可達540MB/s/500MB/s
- 工作溫度：0°C至70°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



PCIe固態硬盤

- 技術：PCIe3.0/PCIe4.0
- 容量：128GB至4TB
- 讀寫速度：最高可達7,400MB/s/6,500MB/s
- 工作溫度：0°C至70°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



便攜式固態硬盤

- 技術：USB3.2
- 容量：128GB至2TB
- 讀寫速度：最高可達2,000MB/s/2,000MB/s
- 工作溫度：0°C至70°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中

應用領域示意



企業級

我們的產品

PCIe企業級固態硬盤

- 技術：PCIe5.0企業級固態硬盤
- 容量：3.84TB至122.88TB
- 讀寫速度：最高可達13GB/s/10GB/s
- 工作溫度：0°C至77°C
- 商業化狀態：
部分容量規格產品已商業化



應用領域示意



業 務

車規級

我們的產品

車規級BGA固態硬盤

- 技術：BGA固態硬盤PCIe4.0
- 容量：256GB至1TB
- 讀寫速度：最高可達3,700MB/s/2,900MB/s
- 工作溫度：-40°C至105°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



應用領域示意



以下是我們的固態硬盤在消費級、企業級及車規級應用場景中的應用：

- **消費級應用場景。**我們的消費級固態硬盤產品線包含SATA固態硬盤、PCIe固態硬盤及便攜式固態硬盤，全面覆蓋各類性能與容量需求。具體而言，SATA固態硬盤為主流設備提供兼具響應速度與穩定性的升級選擇。針對對吞吐量有更高要求的用戶，我們的PCIe固態硬盤支持PCIe3.0及PCIe4.0標準。我們的PCIe固態硬盤適用於遊戲、內容創作及多任務處理等對性能要求較高的應用領域。此外，我們的便攜式固態硬盤採用USB3.2接口，讀寫速度高達2,000MB/s/2,000MB/s，容量區間為128GB至2TB，能為移動辦公與內容創作用戶提供便捷的高速外接存儲方案。
- **企業級應用場景。**我們開發中的PCIe5.0企業固態硬盤擬支持容量高達122.88TB，連續讀寫速度預計將高達13GB/s/10GB/s。一旦實現商業化，彼等的性能與容量表現預期可充分滿足AI訓練、大規模數據分析等需要持續高吞吐量、低延遲及可擴展存儲資源的企業級工作負載需求。
- **車規級應用場景。**我們的車規級BGA固態硬盤能夠在嚴苛的汽車環境條件下穩定運作。其支持-40℃至105℃的寬溫度運作範圍，並將通過AEC-Q100 Grade 2/3認證，同時符合ISO 26262 ASIL B功能安全標準。憑藉強大的耐用性與高帶寬性能，該等固態硬盤將為智能座艙系統及其他需要穩定高速數據處理的車規計算應用，提供可靠的存儲支持。

業務

DRAM

DRAM是一種用於電腦及其他設備的易失性存儲器，用於存儲正在使用或處理中的數據，並需定期刷新以維持所存儲的信息。下圖載列(i)我們的主要DRAM產品的示例圖片及特點及(ii)其部分主要應用領域的示例圖片：

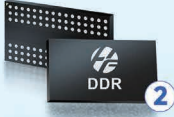
消費級

我們的產品



LPDDR

- 技術：LPDDR4X/LPDDR5X
- 容量：512MB至18GB
- 數據速率：最高可達8,533Mbps
- 工作溫度：-25°C至85°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



DDR

- 技術：DDR3/DDR4/DDR5
- 容量：256MB至3GB
- 數據速率：最高可達6,400Mbps
- 工作溫度：0°C至85°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



DRAM Module

- 技術：DDR3/DDR4/DDR5 DRAM Module
- 容量：2GB至64GB
- 數據速率：最高可達6,400Mbps
- 工作溫度：0°C至70°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中

應用領域示意



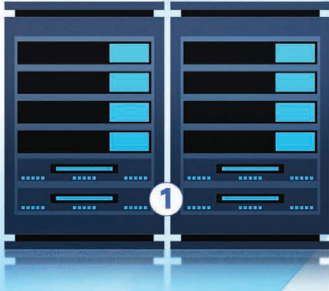
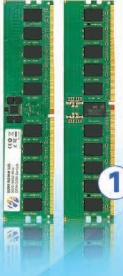
企業級

我們的產品

企業級RDIMM模組

- 技術：DDR4/DDR5 DRAM Module
- 容量：16GB至96GB
- 數據速率：最高 5600Mbps
- 工作溫度：0°C至95°C
- 商業化狀態：部分容量已商業化

應用領域示意



我們的LPDDR系列產品專為滿足移動端及邊緣計算場景對高帶寬及低功耗的需求設計，支持數據傳輸速率最高可達8,533Mbps。在本地AI推理應用中，LPDDR有助於降低延遲、提升任務

業 務

執行效率，優化圖像生成、輔助視頻編輯等應用的系統流暢度。針對搭載AI的智能手機及平板電腦，LPDDR可提供穩定的高吞吐量性能，避免多任務運行時發生卡頓，優化系統響應速度。我們的DRAM模組產品包括DDR3、DDR4及DDR5、UDIMM及SODIMM，均依循JEDEC標準設計，支持最高達6,400Mbps的數據傳輸速率，容量區間涵蓋2GB至64GB。此外，我們的DRAM模組產品亦包括企業級RDIMM模組，支援高達5,600Mbps的數據傳輸速率，容量區間涵蓋16GB至96GB。

移動存儲

移動存儲指作為數據傳輸和備份工具的U盤和存儲卡等便攜式存儲設備。下表載列(i)我們的主要移動存儲產品的示例圖片及特點及(ii)其主要應用領域的示例圖片：

消費級

我們的產品



U盤

- 技術：USB2.0/USB3.0
- 容量：1GB至1TB
- 讀寫速度：最高可達220MB/s/130MB/s
- 工作溫度：0°C至70°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中



microSD

- 技術：microSDHC/microSDXC/UHS-I/V30/A2
- 容量：2GB至256GB
- 讀寫速度：最高可達95MB/s/85 MB/s
- 工作溫度：0°C至70°C
- 商業化狀態：已商業化并持續迭代中

應用領域示意



我們的U盤採用先進的高性能主控芯片與固件，可配置Type-A、Type-C或雙接口設計，滿足不同設備的使用需求。我們的microSD存儲卡連續讀寫速度最高可達95MB/s/85MB/s，容量覆蓋2GB至256GB。

存儲顆粒

我們的存儲顆粒主要包括(i)NAND Flash晶圓及晶粒，及(ii) DRAM晶圓及晶粒。我們銷售的存儲顆粒用於生產嵌入式存儲、固態硬盤、DRAM和移動存儲。通過與供應商建立強大的合作夥伴關係，我們從事存儲顆粒的大規模採購，實現採購規模效益和供應鏈穩定性。在滿足內部生產需求後，我們可能會綜合考量市場狀況、現金流效率、存貨週轉及客戶需求等因素，對外銷售存儲顆粒。

業 務

其他

主控芯片：於往績記錄期間，我們根據客戶需求提供主控芯片。

技術服務：於往績記錄期間，我們提供存儲產品開發、兼容性測試等技術服務。

服務器：於往績記錄期間，我們提供服務器，例如運算服務器及加速服務器。

我們的若干產品具備支持AI相關應用場景的技術能力。具體而言，我們的若干存儲產品在讀寫性能、功耗控制及運行穩定性方面的設計，可滿足邊緣計算、存儲加速及智能終端等AI相關領域的產品要求。具備應用於AI相關應用場景能力的產品收入於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月分別為人民幣1,182.1百萬元、人民幣2,021.9百萬元、人民幣5,454.9百萬元及人民幣3,439.6百萬元，分別佔我們各期間總收入的13.5%、23.2%、48.5%及42.9%。然而，具備應用於AI相關應用場景技術能力的產品，未必最終實際應用於AI相關領域。於往績記錄期間及截至2026年4月30日止四個月，最終實際應用於AI相關領域的產品收入仍然有限。該等收入於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月分別為零、人民幣4.1百萬元、人民幣14.6百萬元及人民幣80.8百萬元，分別佔我們各期間總收入的零、少於0.1%、0.1%及1.0%。

我們的存儲技術平台

我們的存儲技術平台主要包括以下關鍵技術：

- **主控芯片設計與開發。**我們已具備自主設計及開發主控芯片的能力。通過專有芯片架構與電路設計，我們將關鍵通用固件算法轉化為硬件加速原生功能，以達到高讀寫速度與低功耗。同時，我們對芯片尺寸進行優化，在有限佔位面積內實現性能與成本的有效平衡。我們自主設計及開發主控芯片成為我們在市場競爭中的核心優勢來源。

我們從商業化角度規劃主控芯片的設計與研發工作，以存儲產品市場的主流需求為導向。截至最後實際可行日期，除已進入量產階段的主控芯片外，我們自主設計研發的主控芯片共有八款型號，分處送樣、流片、後端設計及前端設計等不同研發階段，形成了兼具高效研發、產品組合多元化及研發管線層級化特點的主控芯片研發能力。具體而言：

- **送樣階段：**適用於(i) UFS2.2及(ii) eMMC5.1的主控芯片；
- **流片階段：**適用於(i) USB3.2、(ii) UFS4.1及(iii) PCIe4.0 SSD的主控芯片；
- **後端設計階段：**適用於(i) PCIe5.0 SSD及(ii)低功耗UFS2.2；及
- **前端設計階段：**適用於UFS5.0的主控芯片。

業 務

隨著自主設計研發的主控芯片在存儲產品中的應用進一步深化，我們預計相關研發能力將進一步鞏固本公司的競爭優勢，降低銷售成本並提升毛利率。

- **固件算法開發。**我們自主開發核心固件算法，包括先進的閃存轉換層、垃圾回收機制、磨損均衡算法及動態低功耗平衡算法，能夠基於硬件能力實現存儲介質的精確調度和優化。這些技術不僅將讀寫速度提升至行業領先水平，還大幅降低了延遲與動態功耗，實現高性能與低功耗的最優平衡，為用戶帶來更流暢、更持久的使用體驗。
- **測試系統開發。**我們構建了覆蓋芯片級至系統級的綜合自主開發測試系統。在芯片級，依託自主研發的MBIST/LBIST框架，我們開展自動化單元測試、模擬老化及極端條件驗證。在系統級，我們部署全平台壓力測試與大規模兼容性測試，搭建堅實的質量保障屏障。該系統可有效識別並解決設計缺陷與潛在故障，顯著提升產品質量與可靠性。此外，我們開發了一套完全自主的量產測試系統，採用高度自動化測試程序、仿真測試方法及先進診斷工具，快速完成產品性能、可靠性、兼容性與老化特性的全面評估。
- **存儲介質特性分析。**針對來自不同供應商的存儲介質（如NAND Flash），我們開展底層深度特性分析，精準分析在不同工藝節點、電壓及溫度下的電學特性與衰減規律。通過充分掌握各供應商介質的特性，我們可根據客戶應用場景精準匹配最適配的存儲介質，提供優化且高性價比的產品。該研究同時為固件算法開發及主控芯片設計與開發奠定技術基礎，支持對存儲介質進行精準分檔篩選，最大化挖掘介質性能，預測並降低介質使用相關潛在風險，從而保障產品在全生命週期內具備卓越的可靠性與長期穩定性。

研發

我們投入大量資源於產品與技術研發。我們的研發團隊由三名核心成員領銜，分別為AW YONG CHEE KONG先生、朱啟傲先生及張興華先生。截至2026年4月30日，我們的研發團隊由867名專業人才組成，其中約50%持有碩士及以上學位。截至2026年4月30日，我們在深圳、合肥、上海、廈門及杭州等多個城市設有研發中心。以下表格載列截至2026年4月30日有關我們研發中心的若干資料。

地點	面積 (平方米)	主要職能	研發人員數量
深圳.....	11,510	我們的總部負責管理及運營，主要負責主控芯片設計及開發、全系列產品研發、產品銷售及業務推廣	347

業 務

地點	面積 (平方米)	主要職能	研發人員數量
合肥.....	6,462	主要負責主控芯片設計及開發，並擔任存儲模組的研發中心	422
上海.....	1,183	主要負責主控芯片設計及開發	30
廈門.....	970	主要負責主控芯片設計及開發，並擔任存儲模組的研發中心	32
杭州.....	1,216	主要負責基於現場可編程門陣列(「 現場可編程門陣列 」)的硬件加速產品的研發	36

於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年4月30日止四個月，我們的研發開支分別為人民幣282.6百萬元、人民幣392.2百萬元、人民幣493.2百萬元、人民幣151.4百萬元及人民幣199.6百萬元，分別佔我們同期收入的3.2%、4.5%、4.4%、5.4%及2.5%。

我們的研發管線

我們保持活躍的產品及組件研發管線，以支持主控芯片及存儲解決方案產品組合的升級與擴展。我們目前的研發管線專注於增強產品功能、提升與不同NAND Flash配置(包括QLC NAND)的兼容性、強化性能、功耗效率及安全特性，並推進我們自主開發的主控芯片能力。下表載列目前正在開發的主要產品及組件、其主要目標功能與特性、當前狀態以及根據我們現有開發計劃所預期的商業化時間表。

項目	主要目標功能及特性	當前狀態／ 預期商業化時間表 ⁽¹⁾
eMMC 5.1主控芯片.....	旨在根據市場反饋優化我們現有的eMMC 5.1主控解決方案，並解決當前產品代際的功能缺口。該項目亦針對QLC NAND Flash的性能適配，目前市場上兼容的eMMC 5.1主控解決方案相對有限	開發中；預期於2026年商業化
UFS 2.2主控芯片....	旨在根據市場反饋優化我們現有的UFS 2.2主控解決方案，並解決當前產品代際的功能缺口。該項目亦針對QLC NAND Flash的性能適配，以提升市場競爭力	開發中；預期於2026年商業化
USB 3.2 Gen1主控芯片.....	旨在加強我們的USB主控能力，包括加入LDPC功能以更好地支持QLC NAND Flash應用。該主控亦擬同時支持Type-A及Type-C USB PHY設計，適用於雙接口USB存儲產品	開發中；預期於2026年商業化

業 務

項目	主要目標功能及特性	當前狀態／
		預期商業化時間表 ⁽¹⁾
PCIe Gen4高速固態硬盤主控芯片...	旨在基於PCIe Gen4 x4技術及12納米製程節點設計為高速固態硬盤主控。目標特性包括：支持基於PCIe Gen4 16GT/s的NVMe 2.0協議、支持接口速度高達2400MT/s的多模NAND Flash，以及協同自主開發的硬件及固件架構。該項目亦針對高性能及低功耗設計能力，並為互聯網、雲計算、金融及電信等行業的應用增強兼容性、安全特性及成本競爭力	開發中；預期於2026年商業化
UFS 4.x主控芯片...	旨在根據市場反饋優化我們的UFS 4.x主控解決方案，並解決當前產品代際的功能缺口。該項目亦旨在為QLC NAND Flash提供性能適配，以預期更具成本效益的QLC UFS 4.x產品進入市場	開發中；預期於2027年商業化
PCIe Gen5高速固態硬盤主控芯片.....	旨在設計為採用PCIe Gen5主機接口的下一代固態硬盤主控，目標順序讀寫性能高達14.8GB/s／14GB/s。該項目擬支持高達4,800MT/s的Flash PHY接口速度，以兼容未來的高性能NAND Flash，並採用無DRAM架構，支持高達16TB容量。該主控預期同時支持TLC及QLC NAND Flash，並適用於多種應用場景，包括較低容量的傳統個人電腦及終端市場，以及較高容量的數據中心及分佈式存儲中的存儲節點應用。	開發中；預期於2027年商業化
低功耗UFS 2.2主控芯片.....	旨在通過基於上一代進一步優化功耗及芯片尺寸，以提升我們現有的UFS 2.2主控解決方案	開發中；預期於2027年商業化
UFS 5.0主控芯片...	旨在按照JEDEC UFS 5.0標準開發UFS 5.0主控芯片的核心技術，填補國內高端存儲控制器領域的技術空白。該項目計劃通過與國內NAND Flash供應商及品牌客戶合作，培育國內UFS生態系統，覆蓋存儲顆粒、主控芯片、模組及終端設備，從而降低供應鏈風險。該項目以國內領先智能手機製造商為初始客戶，目標進入旗艦智能手機型號的供應鏈	開發中；預期於2028年商業化

(1) 我們預期的商業化時間表基於我們當前的開發進度、內部測試及驗證計劃，以及預期的流片、認證及客戶採用時間表。該等時間表可能因(其中包括)產品開發及測試進度、流片及製造計劃、客戶認證要求以及市場狀況等因素而發生變化。

我們已在研發工作中取得多項里程碑。具體而言，我們開發了尺寸為7.5 x 12.5 x 0.78毫米及9 x 7.5 x 0.8毫米的緊湊封裝解決方案，體現了我們在存儲產品上的小型化能力。於2024年，我們

業 務

實現了UFS 4.1模組的首批國內商業化，並成功實施了結合QLC與TLC NAND的融合UFS 4.1解決方案，展示了我們在高性能及差異化存儲解決方案方面的產品開發能力。

我們的研發流程

我們建立了覆蓋主控芯片與模組研發的完整管理流程。該流程主要包括三個關鍵階段：項立項、設計開發及驗證。

- **項目立項階段：**項目需求主要來自市場調研、戰略規劃以及客戶需求，基本的技術指標來自於JEDEC/PCI-SIG等協會，同步參考營銷團隊的客戶定製功能及特定技術參數需求。應用團隊據此轉化為具體的產品功能與技術指標。研發團隊則對主控芯片或模組方案進行技術可行性分析，完成立項報告與研發計劃。經內部審計完成後，最終確定主控芯片和模組的開發方案與產品規格。
- **設計開發階段：**研發團隊依據核准規格，分別開展主控芯片或模組的端到端設計。主控芯片設計開發階段主要包括架構分析及規格制定、RTL設計與編碼、設計驗證、邏輯綜合以及物理實現。模組設計開發階段主要包括主控芯片及NAND Flash選型、硬件電路設計、PCB佈局、固件設計與開發。同時，驗證及核證團隊同步制定主控芯片與模組對應的測試方案與標準。
- **驗證階段：**經芯片探針測試及最終測試後，應用團隊、研發團隊與驗證及核證團隊共同進行系統測試、性能評估及可靠性驗證，確保產品符合設計與應用要求。驗證通過後產品開始試產。根據試產結果，我們對主控芯片和模組進行量產放行評審。

業 務

銷售及營銷

銷售網絡

下表載列我們於往績記錄期間按銷售合同交易對手註冊地地區劃分的收入：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
	(未經審計)									
中國內地	1,824,779	20.8	1,264,609	14.5	4,125,496	36.7	891,622	31.8	2,675,665	33.4
海外	6,955,920	79.2	7,453,803	85.5	7,112,080	63.3	1,912,888	68.2	5,336,610	66.6
中國香港 ⁽¹⁾	6,334,055	72.1	6,717,361	77.0	5,493,413	48.9	1,682,048	60.0	3,601,823	45.0
英國	307,775	3.5	358,163	4.1	118,407	1.1	14,065	0.5	63,443	0.8
中國台灣	167,853	1.9	213,586	2.4	454,487	4.0	163,452	5.8	237,075	3.0
新加坡	10,796	0.1	14,023	0.2	753,368	6.7	7,552	0.3	1,259,573	15.7
其他	135,441	1.6	150,670	1.8	292,405	2.6	45,771	1.6	174,696	2.1
總計	<u>8,780,699</u>	<u>100.0</u>	<u>8,718,412</u>	<u>100.0</u>	<u>11,237,576</u>	<u>100.0</u>	<u>2,804,510</u>	<u>100.0</u>	<u>8,012,275</u>	<u>100.0</u>

(1) 於海外市場中，我們的大部分收入來自中國香港，原因為中國香港是半導體行業常用的交貨樞紐。

銷售渠道

我們的銷售渠道包括直銷及分銷。於往績記錄期間，我們的大部分產品通過直銷銷售，而其餘則通過分銷銷售。下表載列所示期間按銷售渠道劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
	(未經審計)									
直銷	5,072,553	57.8	6,410,628	73.5	7,388,174	65.7	1,797,720	64.1	4,348,085	54.3
分銷	3,708,146	42.2	2,307,784	26.5	3,849,402	34.3	1,006,790	35.9	3,664,190	45.7
總計	<u>8,780,699</u>	<u>100.0</u>	<u>8,718,412</u>	<u>100.0</u>	<u>11,237,576</u>	<u>100.0</u>	<u>2,804,510</u>	<u>100.0</u>	<u>8,012,275</u>	<u>100.0</u>

直銷

我們透過針對性營銷活動觸達直銷客戶，包括行業展會、技術論壇及研討會，籍此有效展示專業實力並與潛在客戶建立聯繫。

我們通常與直銷客戶簽訂框架直銷協議。我們與直銷客戶簽訂的框架直銷協議要項載列如下：

- **下單。**根據客戶需求在採購訂單中明確產品名稱、數量、規格、採購價格及交貨日期。
- **期限。**與直銷客戶簽訂的直銷協議期限通常為一至兩年。

業 務

- **信用期。**我們一般給予直銷客戶最多四個月的信用期。
- **發貨與交付。**我們承擔將訂購產品運輸至直銷客戶指定地點所涉成本及風險。此等風險於直銷客戶確認收貨後向之轉移。
- **產品退貨安排。**除由我們造成的產品質量問題外，我們通常不接受直銷客戶退貨。
- **終止。**如果另一方嚴重違約，任何一方都有權單方面終止本協議。

分銷

我們採用分銷模式，主要是由於(i)我們的產品種類繁多、終端客戶數量龐大；及(ii)不同國家客戶偏好差異顯著。我們的分銷商主要包括貿易商及代理商。分銷商與我們之間屬買賣關係，即分銷商向我們採購產品後轉售予下游客戶。我們於分銷商確認收到我們的產品後確認收入。根據弗若斯特沙利文的資料，我們的分銷模式符合行業規範。下表載列所示期間我們分銷商數量的變動情況：

	截至12月31日或截至該日止年度			截至4月30日或 截至該日止四個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
年／期初分銷商.....	102	102	106	89
新增分銷商.....	59	54	39	22
已終止分銷商 ⁽¹⁾	59	50	56	57
年／期末分銷商數量.....	<u>102</u>	<u>106</u>	<u>89</u>	<u>54</u>

(1) 已終止分銷商指我們於上一年／期內錄得收入但於本年／期內並無錄得任何收入的分銷商。

貿易商

我們的貿易商根據銷售協議採購我們的產品，我們不對該等貿易商的業務運營實施任何控制。具體而言，就我們與貿易商的業務安排而言：(i)我們對該等貿易商的業務運營(包括其銷售或定價政策或營銷活動)並無任何控制權；(ii)我們未就其地理覆蓋範圍施加任何限制或要求；及(iii)該等貿易商無需向我們提供其銷售情況、存貨水平、是否將我們的產品轉售給其客戶，或(倘彼等轉售我們的產品)該等產品的終端用戶身份或其客戶對我們產品的需求情況等相關信息。根據弗若斯特沙利文的資料，我們與貿易商的合作符合行業規範。

董事認為我們並無任何重大渠道壓貨風險，考慮到(i)我們未向貿易商設定銷售目標或最低採購義務；(ii)除產品設計缺陷及質量問題外，我們的貿易商一般不得退貨；(iii)我們的貿易商通常在收到採購訂單後再向我們下單；及(iv)於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未發現任何重大渠道壓貨風險。

業 務

我們與貿易商簽訂的框架銷售協議要項載列如下：

- **下單。**根據貿易商需求在採購訂單中明確產品名稱、數量、規格及採購價格。
- **期限。**與貿易商簽訂的框架銷售協議期限通常為一年。
- **信用期。**我們一般授予貿易商最多30日的信用期。
- **發貨與交付。**我們一般承擔將訂購產品運輸至貿易商指定地點所涉成本及風險。此等風險於貿易商確認收貨後向之轉移。
- **產品退貨安排。**除產品質量問題外，我們不接受貿易商退貨。

代理商

我們的代理商根據產品代理協議購買我們的產品，據此，我們可與代理商共同釐定轉售價格並獲取有關彼等存貨水平及下游客戶的資料。我們採取積極主動的代理商管理方式，以維護市場秩序、合規經營及業務協同。我們依據綜合標準甄選代理商，包括其銷售網絡的覆蓋範圍與質量、聲譽、信譽、財務狀況、銷售策略以及物流與倉儲能力。我們為代理商制定明確的運營指引，涵蓋定價政策及付款要求，以確保其按照我們的市場策略與法律要求開展運營。

我們定期根據銷量、客戶互動及運營合規性評估代理商業績，並據此決定合同續簽與否。根據代理商管理政策，我們與代理商溝通，以評估其銷售進度並最大限度地降低存貨風險。代理商通常於收到採購訂單後才向我們下單，該模式本身已降低其存貨風險並加速週轉。

我們與代理商簽訂的產品代理協議要項載列如下：

- **下單。**根據代理商需求在採購訂單中明確產品名稱、數量、規格、採購價格及交貨日期。
- **期限。**產品代理協議期限通常為1至2年。
- **定價。**面向下游客戶的產品定價由我們與代理商共同磋商釐定。
- **信用期。**我們一般授予代理商最多30日的信用期。
- **服務能力：**我們通常要求代理商配備充足的銷售人員，並定期對其服務及支持能力進行培訓及考核。
- **指定區域：**授權代理商通常獲授權向指定區域內的下游客戶銷售我們的產品。

業 務

- **新客戶登記：**代理商與任何新下游客戶開展合作前，一般須向我們報備該客戶信息。我們核實該意向客戶是否已由其他代理商覆蓋後，將通知該代理商是否可推進合作。
- **發貨與交付。**我們一般承擔將訂購產品運輸至代理商指定地點所涉成本及風險。此等風險於代理商確認收貨後向之轉移。
- **產品退貨安排。**除產品質量問題外，我們通常不接受代理商退貨。

據我們所深知，截至最後實際可行日期，我們的所有分銷商均為獨立第三方。據我們所深知，我們於往績記錄期間並無任何次級分銷商。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與分銷商之間並無重大未解決糾紛或訴訟。

產品退貨

根據我們的政策及與客戶訂立的協議，除產品設計缺陷及質量問題外，已售予客戶的產品不可退回。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無接獲客戶的任何重大產品退貨、換貨、投訴或產品責任索償。由於我們並無接獲因對我們業務屬重大的產品質量及缺陷而提出的重大客戶投訴或更換產品的要求，故於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無產生任何重大保修開支或就有關保修開支作出任何撥備。

定價

我們根據實時市場報價為產品定價。我們通常不會與客戶訂立固定定價的長期協議。在釐定產品定價時，我們會考慮一系列因素，包括原材料成本、估計產能、行政、銷售及分銷開支、同類產品的現行市價、整體市況及我們客戶關係的持續時間。

具體而言，我們產品的定價與主要原材料存儲晶圓的成本密切相關。存儲晶圓的市場價格波動可直接影響我們產品的定價。一般而言，我們存儲產品的售價與存儲晶圓採購成本的趨勢一致。然而，晶圓採購與產品銷售之間存在時間差。為緩解該等風險，我們已加強與定期下達大額訂單的主要客戶的業務關係。此類合作關係可提升需求及產品定價的可預測性，使我們能夠更好地管理原材料存貨水平及生產進度。

銷售及營銷團隊

截至2026年4月30日，我們擁有一支由152名人員組成的銷售及營銷團隊，專注於業務發展、客戶服務及行業覆蓋。銷售及營銷人員定期就我們的現有產品及發展計劃與現有及潛在客戶聯絡，不時與客戶溝通我們產品的詳情(如設計、功能或技術)，專注於與客戶建立長期關係。彼等亦進行市場研究，監察競爭對手的技術發展趨勢及價格變動，分析營銷環境，如競爭對手意圖及客戶需求，並為我們量身打造營銷策略。我們亦尋求通過行業展覽、技術論壇及研討會等多種營銷渠道提升品牌知名度及產品認知度。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026

業 務

年4月30日止四個月，我們的銷售及分銷開支分別為人民幣41.9百萬元、人民幣52.9百萬元、人民幣65.9百萬元、人民幣20.0百萬元及人民幣28.4百萬元。

我們的客戶

我們的客戶包括(其中包括)智能手機及平板電腦製造商、可穿戴設備製造商、模組製造商、Tier 1供應商、汽車製造商及電腦製造商。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自我們前五大客戶的收入分別為人民幣5,210.6百萬元、人民幣5,740.0百萬元、人民幣5,226.5百萬元及人民幣3,273.9百萬元，分別佔我們同期總收入的59.4%、65.7%、46.6%及40.8%。於往績記錄期間各期間，來自我們最大客戶的收入分別佔我們總收入的20.9%、33.4%、15.4%及15.6%。於往績記錄期間，我們的所有前五大客戶均為獨立第三方。據我們所知及截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何可能導致我們與任何主要客戶關係終止的資料或安排。於往績記錄期間，我們的董事及其各自緊密聯繫人，或持有已發行股份總數5%或以上的股東，概無於我們任何前五大客戶中擁有任何權益。

下表載列我們於往績記錄期間各期間前五大客戶的詳情：

排名	客戶	銷售額	佔總收入 百分比	所採購主要 產品／服務類型*	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
		人民幣千元	%				

截至2023年12月31日止年度

1	客戶A ⁽¹⁾	1,836,063	20.9	嵌入式存儲	60天	銀行轉賬	2021年
2	客戶B及其關聯方 ⁽²⁾	1,059,147	12.1	固態硬盤	45天	銀行轉賬	2020年
3	客戶C及其附屬公司 ⁽³⁾ ..	867,615	9.9	嵌入式存儲	90天	銀行轉賬	2022年
4	客戶D ⁽⁴⁾	727,008	8.3	存儲顆粒	預付款項	銀行轉賬	2019年
5	客戶E及其附屬公司 ⁽⁵⁾ ..	720,745	8.2	嵌入式存儲及存儲 顆粒	預付款項	銀行轉賬	2022年

排名	客戶	銷售額	佔總收入 百分比	所採購主要產品／ 服務類型*	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
		人民幣千元	%				

截至2024年12月31日止年度

1	客戶C ⁽³⁾	2,914,783	33.4	嵌入式存儲	90天	銀行轉賬	2022年
2	客戶A ⁽¹⁾	1,840,103	21.1	嵌入式存儲	60天	銀行轉賬	2021年
3	客戶F ⁽⁶⁾	335,122	3.8	固態硬盤及嵌入式 存儲	預付款項	銀行轉賬	2022年
4	客戶D ⁽⁴⁾	332,321	3.8	存儲顆粒	預付款項	銀行轉賬	2019年

業 務

排名	客戶	銷售額	佔總收入 百分比	所採購主要產品／ 服務類型*	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
		人民幣千元	%				
5	客戶G ⁽⁷⁾	317,710	3.6	嵌入式存儲	30天	銀行轉賬	2024年

排名	客戶	銷售額	佔總收入 百分比	所採購主要產品／ 服務類型*	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
		人民幣千元	%				

截至2025年12月31日止年度

1	客戶A及其關聯方 ⁽¹⁾	1,732,429	15.4	嵌入式存儲	60天	銀行轉賬	2021年
2	客戶G ⁽⁷⁾	1,508,873	13.4	嵌入式存儲	30天	銀行轉賬	2024年
3	客戶C及其附屬公司 ⁽³⁾ ...	893,411	8.0	嵌入式存儲	90天	銀行轉賬	2022年
4	客戶H及其附屬公司 ⁽⁸⁾ ...	703,459	6.3	DRAM及嵌入式存儲	30天	銀行轉賬	2023年
5	客戶I及其關聯方 ⁽⁹⁾	388,346	3.5	DRAM	預付款項	銀行轉賬	2024年

排名	客戶	銷售額	佔總收入 百分比	所採購主要產品／ 服務類型*	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
		人民幣千元	%				

截至2026年4月30日止四個月

1	客戶A及其關聯方 ⁽¹⁾	1,247,994	15.6	嵌入式存儲	60天	銀行轉賬	2021年
2	客戶G ⁽⁷⁾	786,125	9.8	嵌入式存儲	30天	銀行轉賬	2024年
3	客戶C及其附屬公司 ⁽³⁾ ...	473,132	5.9	嵌入式存儲	90天	銀行轉賬	2022年
4	客戶J及其關聯方 ⁽¹⁰⁾	410,327	5.1	嵌入式存儲、移動存 儲及固態硬盤	30至60天	銀行轉賬	2023年
5	客戶K ⁽¹¹⁾	356,278	4.4	嵌入式存儲	預付款項	銀行轉賬	2026年

* 所採購的主要產品／服務類型指相關客戶採購的主要產品類別，而「我們的產品」所載的下游應用分類乃參考相關產品的預期最終用途、產品規格、性能要求、可靠性要求及適用認證標準釐定。因此，相同產品類別（例如嵌入式存儲或固態硬盤）內的產品，可能會根據其規格及預期用途被歸類為不同的下游應用場景。

(1) 客戶A為2014年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事電子產品及相關零部件的買賣與分銷，服務對象涵蓋消費電子及智能設備領域客戶。

業 務

- (2) 客戶B為2018年成立的存儲器模組製造公司，於中國廣東省註冊，主要從事存儲器模組及存儲產品的設計、研發與封裝。
- (3) 客戶C為2010年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事消費電子及智能硬件產品的貿易與分銷。
- (4) 客戶D為2006年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事電子產品及相關元器件的貿易與分銷。
- (5) 客戶E為2014年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事電子產品及相關元器件的貿易與分銷。
- (6) 客戶F為2022年成立的公司，於英屬維爾京群島註冊，主要從事半導體元器件及電子產品的分銷與貿易。
- (7) 客戶G為2024年成立的公司，於中國上海註冊，主要從事存儲產品及相關電子設備的研發、製造與銷售。
- (8) 客戶H為2003年成立的消費電子及移動通信設備製造商，於中國廣東省東莞市註冊，主要從事智能手機及相關智能硬件的研發、製造與銷售。
- (9) 客戶I為2008年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事電子元器件及相關產品的分銷及貿易。
- (10) 客戶J為2023年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事存儲產品貿易及分銷。
- (11) 客戶K為2026年成立的公司，於中國深圳註冊，主要從事存儲產品貿易及分銷。

我們的供應商

原材料供應商

我們存儲產品的原材料主要包括(i)存儲晶圓；及(ii)主控芯片。我們主要(i)向存儲原廠採購存儲晶圓；及(ii)向主控芯片供應商採購主控芯片。我們通常與原材料供應商訂立框架協議，當中載列採購的一般條款及條件。該等協議的主要條款通常包括：

- **下達訂單**：採購訂單(包括產品名稱、數量、單價及總採購金額)將單獨下達。
- **交付**：供應商通常負責將所訂購產品交付至我們指定的地點。
- **付款**：信用期及付款方式須按照採購訂單執行。我們通常獲授最長90天的信用期。
- **產品退貨**：我們自行進行產品檢驗。倘供應商提供的產品未能通過我們的檢驗，則可予退貨，相關費用由供應商承擔。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，原材料供應商與我們之間並無就產品退貨及退款產生重大索償。
- **期限**：協議的有效期限通常為一至兩年。
- **終止**：任何一方均有權在提前30天發出書面通知后終止協議。

業 務

於往績記錄期間，我們採購貨品的交付地點主要為中國香港及中國內地。根據我們的採購記錄及我們所獲得的資料，我們主要供應商所供應貨品的原產地主要為韓國、日本、中國內地、中國台灣及新加坡。

服務供應商

存儲產品的生產流程主要包括(i)晶圓加工，(ii)封裝測試及(iii)SMT與測試。我們將該等流程外包予服務供應商。

我們的服務供應商主要包括晶圓製造商及OSAT供應商。晶圓製造商向我們提供晶圓加工服務。OSAT供應商向我們提供(i)封裝測試服務，及(ii)SMT與測試服務。我們通常與服務供應商訂立框架協議。該等協議的主要條款通常包括：

- **服務範圍**：服務供應商根據工單中列明的產品規格製造我們所需的產品。
- **付款**：生產成本由雙方在工單中協定。我們在收到產品後支付加工費，服務供應商通常向我們提供30–90日的信用期。
- **產品退貨**：我們自行進行產品檢驗。若服務供應商提供的產品未能通過我們的檢驗，則可予以退貨，且相關費用由服務供應商承擔。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，服務供應商與我們之間並無就產品退貨及退款發生重大申索。
- **期限**：協議的有效期通常為三年。
- **終止**：如果服務供應商違反其義務，我們有權要求其在指定期限內糾正此類違約行為，否則我們可以單方面終止協議。

供應商管理

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括(i)原材料供應商，及(ii)服務供應商。我們通常聘用信譽良好、業績卓著的供應商，以確保產品質量。

我們有供應商管理政策，確保供應鏈穩定，優化成本效益，保證質量合規。我們的供應商管理政策覆蓋整個合作過程，包括篩選、評估、績效追蹤和可能發生的合作終止情形。在選擇供應商時，我們會綜合考量多個因素，主要包括成本競爭力、交付可靠性、質量保證水平和技術能力。新供應商必須經過嚴格的資格審查流程，包括能力評估、材料認證、現場檢查和合同簽署，然後才可納入我們的認可供應商名單。現有供應商須接受定期績效審查，並根據績效分類管理。未能達到業績預期的供應商可能會需要執行整改計劃、降低採購量或終止合同。

我們的主要供應商

於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自我們前五大供應商的採購額分別為人民幣3,808.5百萬元、人民幣4,182.5百萬元、人民幣6,616.4百萬元及人民幣4,310.2百萬元，分別佔我們總採購額的43.5%、49.4%、55.5%及63.0%。此外，截至2023年、2024年、2025

業 務

年12月31日止年度以及截至2026年4月30日止四個月，我們最大供應商的採購額分別佔我們總採購額的12.6%、11.6%、15.7%及19.8%。於往績記錄期間，除供應商D外，我們的所有前五大供應商均為獨立第三方。於往績記錄期間，本集團董事及其各自緊密聯繫人，或持有我們已發行股份總數5%以上的股東，除供應商D外，概無於我們的前五大供應商中擁有任何權益。我們與供應商D的交易乃於一般業務過程中進行，並按公平磋商的商業條款執行。此外，我們於往績記錄期間與供應商並無發生任何重大糾紛。

下表載列於往績記錄期間各期間我們的前五大供應商的詳情：

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購 總額百分比 (%)	主要所提供產品／ 服務類型	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
截至2023年12月31日止年度							
1	供應商A ⁽¹⁾	1,103,317	12.6	晶圓	30天	銀行轉賬	2021年
2	供應商B及其關聯方 ⁽²⁾ ..	1,006,589	11.5	晶圓以及測試及包裝服務	30至60天	銀行轉賬	2020年
3	供應商C ⁽³⁾	640,154	7.3	晶圓	預付款項	銀行轉賬	2023年
4	供應商D ⁽⁴⁾	532,802	6.1	主控芯片	45天	銀行轉賬	2019年
5	供應商E ⁽⁵⁾	525,605	6.0	晶圓	60天	銀行轉賬	2022年
排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購 總額百分比 (%)	主要所提供產品／ 服務類型	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
截至2024年12月31日止年度							
1	供應商D ⁽⁴⁾	978,559	11.6	晶圓及主控芯片	45天	銀行轉賬	2019年
2	供應商C ⁽³⁾	922,779	10.9	晶圓	預付款項	銀行轉賬	2023年
3	供應商F及其附屬公司 ⁽⁶⁾	874,160	10.3	晶圓	60天	銀行轉賬	2023年
4	供應商G ⁽⁷⁾	815,643	9.6	晶圓	30天	銀行轉賬	2020年
5	供應商H ⁽⁸⁾	591,359	7.0	晶圓	89天	銀行轉賬	2024年

業 務

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購 總額百分比 (%)	主要所提供產品／ 服務類型	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
----	-----	-----------------	---------------------	------------------	-----	------	--------------

截至2025年12月31日止年度

1	供應商F及其附屬公司 ⁽⁶⁾ ...	1,871,205	15.7	晶圓	60天	銀行轉賬	2023年
2	供應商H ⁽⁸⁾	1,332,901	11.2	晶圓	89天	銀行轉賬	2024年
3	供應商D ⁽⁴⁾	1,217,048	10.2	晶圓及主控芯片	45天	銀行轉賬	2019年
4	供應商G ⁽⁷⁾	1,123,645	9.4	晶圓、主控芯片及 DRAM	30天	銀行轉賬	2020年
5	供應商I ⁽⁹⁾	1,071,616	9.0	晶圓及DRAM	預付款項	銀行轉賬	2019年

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購 總額百分比 (%)	主要所提供產品／ 服務類型	信用期	支付方式	業務關係 開始年份
----	-----	-----------------	---------------------	------------------	-----	------	--------------

截至2026年4月30日止四個月

1	供應商F及其附屬公司 ⁽⁶⁾ ...	1,355,140	19.8	晶圓	60天	銀行轉賬	2023年
2	供應商J ⁽¹⁰⁾	1,225,318	17.9	晶圓	預付款項	銀行轉賬	2026年
3	供應商H ⁽⁸⁾	750,059	11.0	晶圓及DRAM	89天	銀行轉賬	2024年
4	供應商D ⁽⁴⁾	546,739	8.0	主控芯片	45天	銀行轉賬	2019年
5	供應商A ⁽¹⁾	432,912	6.3	晶圓	30天	銀行轉賬	2021年

- (1) 供應商A為1996年成立的貿易及分銷公司，於中國香港註冊，主要從事電子元器件及相關產品的進出口與銷售。
- (2) 供應商B為2009年成立的貿易及分銷公司，於中國香港註冊，主要從事電子元器件的貿易及分銷及相關供應鏈服務。
- (3) 供應商C為1996年成立的電子元器件貿易公司，於中國香港註冊，主要從事半導體設備及相關電子產品的分銷與供應。
- (4) 供應商D為2000年成立的公司，於中國台灣註冊，於證券櫃檯買賣中心上市，主要從事NAND flash主控芯片及存儲解決方案的研發、製造與銷售。
- (5) 供應商E為2015年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事存儲器模組的研發、製造與銷售。
- (6) 供應商F為2005年成立的公司，於中國深圳註冊，主要從事半導體元器件及電子產品的分銷與技術服務。
- (7) 供應商G為2012年成立的電子產品貿易公司，於中國香港註冊。

業 務

- (8) 供應商H為2022年成立的公司，於中國深圳註冊，主要從事電子元器件及集成電路的貿易流通以及提供相關供應鏈服務。
- (9) 供應商I為2010年成立的公司，於中國香港註冊，主要從事存儲器模組及閃存存儲解決方案的設計、製造與銷售。
- (10) 供應商J為2023年成立的公司，於新加坡註冊，其為一家領先的基於NAND flash技術的數據存儲設備及解決方案開發商、製造商及供應商的全資附屬公司。

重疊客戶及供應商

於往績記錄期間各期間，我們的前五大客戶合共包括11名客戶，其中四名（客戶B、客戶E、客戶H及客戶I）及／或其關聯公司亦為我們的供應商。於往績記錄期間各期間，我們的前五大供應商合共包括10名供應商，其中六名（供應商A、供應商B、供應商D、供應商F、供應商H及供應商I）及／或其關聯公司亦為我們的客戶。

我們主要向客戶B及其關聯方銷售固態硬盤，並向客戶B及其關聯方採購固態硬盤及DRAM。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，來自客戶B及其關聯方的收入分別為人民幣1,059.1百萬元、人民幣152.2百萬元、人民幣189.6百萬元及人民幣40.3百萬元，分別佔我們各該期間總收入的約12.1%、1.7%、1.7%及0.5%。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，向客戶B及其關聯方的採購額分別為人民幣170.5百萬元、人民幣61.9百萬元、人民幣43.6百萬元及人民幣7.6百萬元，分別佔我們各該期間總採購額的約1.9%、0.7%、0.4%及0.1%。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，我們向客戶B及其關聯方銷售的毛利率分別為2.1%、13.7%、10.3%及79.4%。2025年我們向客戶B及其關聯方銷售的毛利率低於我們該期間的整體毛利率，主要原因為我們於2025年與客戶B及其關聯方的主要交易為2025年上半年的固態硬盤採購，而當時固態硬盤價格處於行業週期性低位，導致毛利率較低。

我們主要向客戶E及其附屬公司銷售嵌入式存儲及存儲顆粒，並向其關聯方採購晶圓。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，來自客戶E及其附屬公司的收入分別為人民幣720.7百萬元、人民幣206.8百萬元、人民幣7.2百萬元及零，分別佔我們各該期間總收入的約8.2%、2.4%、0.1%及零。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，向其關聯方的採購額分別為零、零、人民幣109.6百萬元及人民幣126.3百萬元，分別佔我們各該期間總採購額的約零、零、0.9%及1.8%。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，我們向客戶E及其附屬公司銷售的毛利率分別為負9.6%、16.2%、負0.7%及零。2023年我們向客戶E及其附屬公司銷售的毛利率低於我們該期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶銷售的嵌入式存儲產品主要為eMMC產品，而該類產品的整體毛利率於2023年相對較低。2025年我們向客戶E及其附屬公司銷售的毛利率低於我們該期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶的銷售主要集中在當年上半年，而當時市場價格處於相對較低水平。

我們主要向客戶H及其附屬公司銷售DRAM及嵌入式存儲，並向其附屬公司採購智能手機。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，來自客戶H及其附屬公司的收入分別為人民幣10.4百萬元、人民幣251.4百萬元、人民幣703.5百萬元及人民幣171.3百萬元，分別佔我們各該期間總收入的約0.1%、2.9%、6.3%及2.1%。於2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月，向客戶H的附屬公司的採購額分別為零、人民幣1.2百萬元、零及人民幣0.4百萬元，分別佔我們各該期間總採購額的約零、不足0.1%、零及不足0.1%。於2023年、2024年、2025年及

業 務

截至2026年4月30日止四個月，我們向客戶H及其附屬公司銷售的毛利率分別為26.8%、負14.9%、6.2%及負6.2%。2023年我們向客戶H及其附屬公司銷售的毛利率高於我們該期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶銷售的產品主要為高端UFS 3.1產品，該等產品通常具有較高的毛利率。2024年、2025年及截至2026年4月30日止四個月我們向客戶H及其附屬公司銷售的毛利率低於我們該等期間的整體毛利率，主要原因為我們為維持客戶關係而與該客戶訂立了若干固定價格供應安排，且期間產品成本上升導致毛利率下降，並在某些情況下出現毛損。

我們主要向客戶I及其關聯方銷售DRAM，並向其關聯方採購DRAM。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自客戶I及其關聯方的收入分別為零、人民幣170.9百萬元、人民幣388.3百萬元及零，分別佔我們各該期間總收入的約零、2.0%、3.5%及零。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向客戶I的關聯方採購額分別為零、人民幣8.6百萬元、零及零，分別約佔我們各該期間總採購額的約零、0.1%、零及零。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們向客戶I及其關聯方銷售的毛利率分別為零、負13.5%、23.3%及零。2024年我們向客戶I及其關聯方銷售的毛利率低於我們該期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶銷售的產品為DRAM，而DRAM的整體毛利率於2024年為負數。我們向客戶I及其關聯方銷售的毛利率與我們該期間DRAM產品的整體毛利率並無重大差異。

我們主要向供應商A的關聯方銷售嵌入式存儲、固態硬盤及DRAM，並向供應商A採購晶圓。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自供應商A的關聯方的收入分別為零、人民幣10.5百萬元、人民幣104.4百萬元及人民幣78.3百萬元，分別佔我們各該期間總收入的約零、0.1%、0.9%及1.0%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向供應商A的採購額分別為人民幣1,103.3百萬元、人民幣246.3百萬元、人民幣1,049.3百萬元及人民幣432.9百萬元，分別約佔我們各該期間總採購額的約12.6%、2.9%、8.8%及6.3%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們向供應商A的關聯方銷售的毛利率分別為零、負5.2%、26.2%及83.3%。2024年我們向供應商A銷售的毛利率低於我們該期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶銷售的固態硬盤產品為轉售產品，利潤率相對較低，且在分配減值虧損後，該等銷售錄得虧損。

我們主要向供應商B及其關聯方銷售嵌入式存儲及DRAM，並向供應商B及其關聯方採購晶圓以及測試及封裝服務。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自供應商B及其關聯方的收入分別為人民幣4.5百萬元、人民幣11.6百萬元、人民幣176.5百萬元及人民幣157.0百萬元，分別佔我們各該期間總收入的約不足0.1%、0.1%、1.6%及2.0%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向供應商B及其關聯方的採購額分別為人民幣1,006.6百萬元、人民幣550.7百萬元、人民幣616.3百萬元及人民幣321.5百萬元，分別約佔我們各該期間總採購額的約11.5%、6.5%、5.2%及4.7%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們向供應商B及其關聯方銷售的毛利率分別為8.7%、35.0%、28.0%及74.5%。2023年及2024年我們向供應商B及其關聯方銷售的毛利率高於我們該等期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶銷售的產品主要為高端UFS 3.1產品，該等產品通常具有較高的毛利率。2025年我們向供

業 務

應商B及其關聯方銷售的毛利率高於我們該期間的整體毛利率，主要因為向該客戶的銷售主要集中在2025年下半年，尤其是第四季度，該期間的毛利率相對較高。

我們主要向供應商D提供存儲產品開發及兼容性測試等技術服務，並向供應商D採購主控芯片及晶圓。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自供應商D的收入分別為人民幣76.2百萬元、人民幣19.3百萬元、人民幣1.3百萬元及零，分別佔我們各該期間總收入的約0.9%、0.2%、不足0.1%及零。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向供應商D的採購額分別為人民幣532.8百萬元、人民幣978.6百萬元、人民幣1,217.0百萬元及人民幣546.7百萬元，分別約佔我們各該期間總採購額的約6.1%、11.6%、10.2%及8.0%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們向供應商D銷售的毛利率分別為63.7%、69.2%、71.3%及零。2023年、2024年及2025年我們向供應商D銷售的毛利率均高於我們各該期間的整體毛利率，主要因為我們主要向該客戶提供技術服務，而該等服務通常具有較高的毛利率。

我們主要向供應商F及其附屬公司銷售嵌入式存儲及DRAM，並向供應商F及其附屬公司採購晶圓。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自供應商F及其附屬公司的收入分別為零、零、人民幣79.2百萬元及人民幣213.1百萬元，分別佔我們各該期間總收入的約零、零、0.7%及2.7%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向供應商F及其附屬公司的採購額分別為人民幣401.9百萬元、人民幣874.2百萬元、人民幣1,871.2百萬元及人民幣1,355.1百萬元，分別約佔我們各該期間總採購額的約4.6%、10.3%、15.7%及19.8%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們向供應商F及其附屬公司銷售的毛利率分別為零、零、62.5%及77.0%。2025年我們向供應商F及其附屬公司銷售的毛利率高於我們該期間的整體毛利率，主要因為我們向該客戶的銷售集中在2025年第四季度，而自2025年下半年起存儲產品價格強勁上漲，使得相應期間的毛利率相對較高。

我們主要向供應商H及其附屬公司銷售固態硬盤，並向供應商H採購晶圓。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自供應商H及其附屬公司的收入分別為零、零、人民幣10.1百萬元及人民幣92.5百萬元，分別佔我們各該期間總收入的約零、零、0.1%及1.2%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向供應商H的採購額分別為零、人民幣591.4百萬元、人民幣1,332.7百萬元及人民幣750.1百萬元，分別約佔我們各該期間總採購額的約零、7.0%、11.2%及11.0%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們向供應商H及其附屬公司銷售的毛利率分別為零、零、0.07%及87.3%。2025年我們向供應商H銷售的毛利率低於我們該期間的整體毛利率，主要因為我們向該客戶銷售的產品僅為一批數量有限的固態硬盤產品。該等產品的定價與同期可資比較產品的現行市價一致；然而，由於相關原材料的採購成本相對較高，導致毛利率較低。

我們主要向供應商I銷售移動存儲，並向供應商I採購晶圓及DRAM。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，來自供應商I的收入分別為人民幣6.3百萬元、零、人民幣0.3百萬元及零，分別佔我們各該期間總收入的約不足0.1%、零、不足0.1%及零。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，向供應商I的採購額分別為人民幣224.6百萬元、人民幣459.9百萬元、人民幣1,071.6百萬元及人民幣380.8百萬元，分別約佔我們各該期間總採購額的約2.6%、5.4%、9.0%及5.6%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，

業 務

我們向供應商I銷售的毛利率分別為負0.04%、零、0.9%及零。2023年及2025年我們向供應商I銷售的毛利率低於我們各該期間的整體毛利率，主要原因為向該客戶銷售的產品主要包括SD卡及PCB板，該等產品通常毛利率較低。

此等供應商與客戶重疊的原因如下：(i)我們曾向智能手機行業的客戶購入少量智能手機作測試用途；(ii)在與若干貿易公司的業務往來中，我們既向其採購原材料，亦向其銷售存儲產品；(iii)我們曾與從事不同業務的大型集團旗下附屬公司進行獨立的採購或銷售交易；及(iv)我們向主要從事存儲產品生產的客戶採購少量我們自身未佈局的特定規格存儲產品。

與上述客戶及供應商的銷售協議及採購協議的條款及條件，乃按公平基準磋商且與其他可資比較客戶及供應商的條款及條件基本一致。根據弗若斯特沙利文的資料，客戶與供應商存在重疊的現象於行業內屬常見情況。

客戶供應安排

自2024年4月起，我們與客戶G訂立了一項客戶供應安排，據此，客戶G向我們提供晶圓作為生產嵌入式存儲產品的原材料，而我們則向客戶G銷售相應的嵌入式存儲產品（「客戶供應安排」）。根據弗若斯特沙利文的資料，該等安排在業內並不罕見。訂立客戶供應安排的商業理由為鎖定客戶需求及銷量、降低我們的運營資金需求及對晶圓存貨風險及晶圓價格波動的風險敞口，以及加強與客戶G的供應鏈協調。根據客戶供應安排，我們不承擔客戶G所提供晶圓的存貨風險，亦不承擔該等所供應晶圓的晶圓價格波動風險。

於2024年4月之前並無客戶供應安排。客戶供應安排項下產生的收入確認為嵌入式存儲產品的銷售收入。因此，從會計角度，為反映該等安排的財務及商業實質，客戶G所提供晶圓的價值自我們的收入及銷售成本中扣除。於2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，客戶供應安排項下來自客戶G的收入分別為人民幣317.7百萬元、人民幣1,508.9百萬元及人民幣786.1百萬元，分別佔我們各該期間總收入的3.6%、13.4%及9.8%。客戶供應安排項下向客戶G銷售的嵌入式存儲總銷量（以GB計）分別為4,271.7百萬GB、18,015.8百萬GB及8,031.8百萬GB，分別佔我們各該期間嵌入式存儲總銷量（以GB計）的27.6%、68.5%及75.2%。

客戶供應安排影響了我們嵌入式存儲收入、平均售價及利潤率的呈列。我們嵌入式存儲產生的收入由2024年的人民幣5,687.7百萬元減少5.6%至2025年的人民幣5,369.9百萬元，主要是由於我們嵌入式存儲的平均售價由2024年的每GB人民幣0.37元下降45.9%至2025年的每GB人民幣0.20元。該下降主要歸因於客戶供應安排下的收入確認方法，據此，嵌入式存儲的收入按我們向客戶G銷售嵌入式存儲的收入減去客戶G為製造該等嵌入式存儲所提供的晶圓成本計算。倘排除客戶供應安排項下產生的收入，我們嵌入式存儲於2024年及2025年的平均售價將分別為每GB人民幣0.48元及每GB人民幣0.47元，保持相對平穩。雖然該等安排通常會降低嵌入式存儲產品的呈報平均售價，但同時亦降低我們所面臨的晶圓採購風險及存貨價格波動風險，並支持銷量增長。

業 務

綜合考慮上述因素，我們接受客戶供應安排下的當前毛利率水平，該安排在某種程度上導致我們的嵌入式存儲產品毛利率由2024年至2025年有所下降。截至2026年4月30日止四個月，我們的嵌入式存儲產生的收入較2025年同期大幅增加，主要由於我們嵌入式存儲的呈報平均售價由每GB人民幣0.23元上升至每GB人民幣0.51元，反映了儘管客戶供應安排對我們的平均售價持續產生影響，期內存儲產品市場價格仍在上升。倘不包括客戶供應安排項下產生的收入，我們嵌入式存儲的平均售價將由截至2025年4月30日止四個月的每GB人民幣0.40元上升至2026年同期的每GB人民幣1.75元。

我們目前預期客戶供應安排將於短期內繼續進行。然而，該等安排的規模是否會增加將取決於多項因素，包括行業狀況、客戶需求及整體市場發展。倘客戶供應安排下的銷售比例增加，我們嵌入式存儲產品的呈報收入及平均售價可能繼續受到上述淨額呈列的影響，且我們的收入狀況及盈利能力指標可能更受該等安排商業條款的影響。此外，由於客戶G為我們的主要戰略合作夥伴之一，我們嵌入式存儲銷售的較大部分繼續在我們長期、互利的客戶供應安排下產生。雖然這導致一定程度的客戶集中，但反映了我們之間的深度合作夥伴關係，預期不會對我們的議價能力造成重大影響，亦不會產生重大客戶依賴問題。然而，我們相信該等安排亦為我們提供了相對穩定的需求並降低了晶圓採購風險。

轉讓定價安排

於往績記錄期間，我們主要通過中國內地及香港的附屬公司開展經營活動。我們的集團內交易主要包括(i)原材料及製成品的採購與銷售、(ii)專利授權交易及(iii)集團內服務。我們參照相關司法管轄區適用的轉讓定價法律法規及OECD轉讓定價指南，就集團內交易定價採用公平原則。

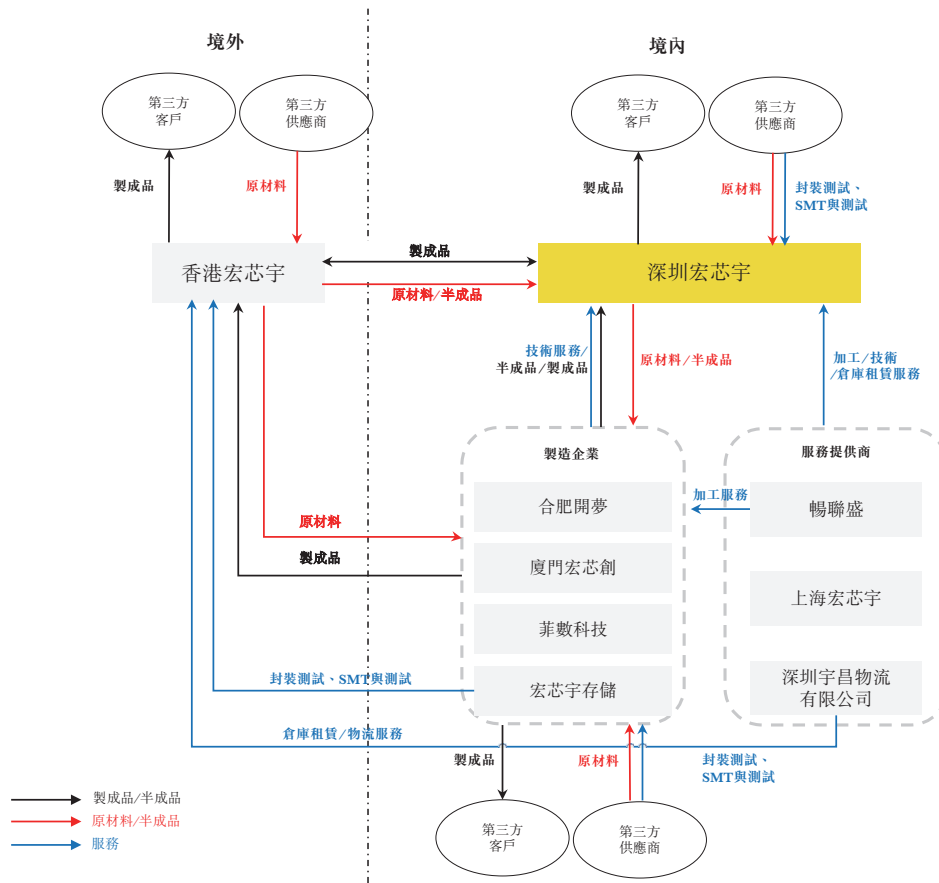
相關司法管轄區適用的轉讓定價法律法規

- *中國內地*。我們的中國實體須遵守(其中包括)(i)《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例；(ii)《中華人民共和國稅收徵收管理法》及其實施細則；(iii)《特別納稅調整實施辦法(試行)》(國家稅務總局公告2017年第6號)；及(iv)《國家稅務總局關於完善關聯交易申報和同期資料管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第42號)。我們的中國實體已根據上述規定，識別、分析及披露主要關聯交易，以支持關聯定價的合理性。
- *中國香港*。中國香港一般遵循OECD轉讓定價指南，該指引體現公平原則，並參考相關方履行的職能、承擔的風險及使用的資產提供可比性標準。我們的轉讓定價顧問認為，OECD轉讓定價指南與中國內地及中國香港的轉讓定價框架一致。

業務

本集團內物流及業務安排

下圖說明於往績記錄期間相關集團實體之間及所涉及司法管轄區的主要物流及業務安排：



上圖旨在概述主要的集團內流轉，無意描述所有交易。

轉讓定價顧問的評估

我們已委任安永(中國)企業諮詢有限公司深圳分公司為我們的轉讓定價顧問，以審閱我們於往績記錄期間的轉讓定價安排。轉讓定價顧問對相關集團實體進行功能分析(包括評估職能的履行、資產的使用及風險的承擔)，並應用符合公平原則的轉讓定價方法，主要為交易淨利潤法(「交易淨利潤法」)，並在適當情況下應用可比非受控價格方式(「可比非受控價格方式」)，以比較獨立公司及／或第三方合同／報價區間作為基準。

根據已完成的基準及審查程序，轉讓定價顧問總結認為，我們於往績記錄期間的集團內定價大致符合公平原則，且我們的整體轉讓定價調整風險較低。具體而言，轉讓定價顧問的審閱

業 務

包括(i)集團內貨物銷售／採購及相關生產安排(通常採用交易淨利潤法，使用合適的利潤水平指標(如全成本加成)進行測試)；存儲產品製造商的利潤範圍為0.2%至14.5%，中位數為3.6%；合肥開夢的利潤水平在此範圍內，而本公司、廈門宏芯創及菲數的利潤水平分別為29.3%、26.3%及30.3%，高於此範圍，主要由於(a)其受惠於2025年下半年及截至2026年4月30日止四個月的存儲產品行業上升週期，產品價格上升帶動收入及毛利增長，及(b)該等實體承擔較高職能及風險或從事較高附加值業務；服務提供商的利潤範圍為1.8%至10.1%，中位數為4.9%，上海宏芯宇的利潤水平在此範圍內；(ii)分銷安排(通常採用交易淨利潤法，使用經營利潤率進行測試)；存儲產品分銷商的利潤範圍為2.5%至5.1%，中位數為3.4%；香港宏芯宇的經營利潤率為11.4%，高於此範圍，主要由於其大部分產品直接銷售予第三方，且其利潤率受惠於2025年下半年以來存儲產品價格上升；及(iii)封裝測試、物流、加工及倉庫租賃服務(在適用的情況下，參考可比第三方定價範圍，採用可比非受控價格方式進行基準比較)；該等集團內公司間交易所採用的定價方法視乎相關服務的性質而有所不同，且相關定價在適用的可比價格範圍內。轉讓定價顧問亦考慮了於往績記錄期間影響若干實體的業務特定因素(包括外部限制及業務遷移)，並評估所觀察到的利潤波動是否可歸因於轉讓定價，而非商業／運營因素。

根據轉讓定價顧問的上述審閱及結論，我們的董事認為於往績記錄期間，我們的轉讓定價安排於所有重大方面符合經合組織轉讓定價指引及相關司法管轄區適用轉讓定價法律法規項下的公平原則，且本集團面臨重大轉讓定價調整或額外稅項付款的風險較低。我們的董事進一步確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，吾等並不知悉我們經營所在司法管轄區的任何稅務機關就我們的集團內部交易提出查詢、審查、調查或質疑。

美國出口管制、制裁及合肥兆芯被列入實體清單

實體清單指定、限制性質及範疇及影響概覽

於2022年12月16日，美國商務部工業和安全局(「**BIS**」)將我們的全資附屬公司合肥兆芯電子有限公司(「**合肥兆芯**」)列入實體清單。**BIS**聲明，將合肥兆芯納入實體清單，係因該局掌握資料顯示，包括合肥兆芯在內的若干公司存在將物品轉讓至實體清單方(即Huawei Technologies Co., Ltd.(「**Huawei**」)及Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.(「**Hikvision**」))的重大風險，**BIS**認為此舉違反《出口管理條例》(「《**出口管理條例**」」)項下美國國家安全與外交政策利益。經對本集團的銷售記錄進行內部審閱後，我們確認本集團(包括合肥兆芯)成立以來從未與Huawei或Hikvision進行任何業務交易，亦從未向Huawei或Hikvision銷售任何產品。

實體清單指定限制了合肥兆芯在未獲得**BIS**許可的情況下，採購或獲取受《出口管理條例》限制的若干商品、軟件及技術(「受《**出口管理條例**》限制的物品」)的能力。根據《出口管理條例》，受《出口管理條例》限制的物品包括：(1)美國境內的所有物品；(2)所有原產於美國的物品，不論位於何處；(3)含有超過最低比例受控美國原產內容的若干非美國原產物品；(4)為若干美國技術

業 務

與軟件的直接產品的若干非美國原產物品；及(5)為若干美國技術及軟件直接產品的整個工廠或主要的工廠組成部分生產的若干非美國原產物品。

經我們的國際制裁法律顧問確認，合肥兆芯被列入實體清單，須受《出口管理條例》項下的實體清單許可規定(包括《出口管理條例》規則第744.11條)規限，因此，向合肥兆芯出口、再出口或轉讓(國內)受《出口管理條例》限制的物品，可能須根據適用的實體清單規定取得BIS許可。根據《出口管理條例》規定，合肥兆芯採購不受《出口管理條例》限制的物品不受約束。實體清單指定乃基於接收方的出口管制措施，其本身並不禁止合肥兆芯進行對外銷售活動、外部服務、售後活動(包括提供零部件)，或合肥兆芯自身的財務活動或研發活動；然而，倘該等活動依賴於取得受《出口管理條例》限制的物品、軟件或技術，則可能受到實際影響。此外，經我們的國際制裁法律顧問確認，BIS對合肥兆芯施加的限制並不適用於本集團的其他成員公司(如若關聯規則日後恢復實施，則合肥億超(由合肥兆芯全資擁有)將須遵守實體清單許可規定)，且不應對我們的供應鏈、業務運營、財務表現、研發能力以及產品及服務組合造成任何重大影響。詳情請參閱「對本集團其他成員公司的適用性、指定後的轉讓／調整及不構成規避／違反的依據」。

存貨銷售及遵守《出口管理條例》以及其他貿易管制

合肥兆芯於2015年6月11日成立。在被列入實體清單前，合肥兆芯主要從事(1)存儲產品的研發、設計及銷售，及(2)主控芯片的銷售。被列入實體清單後，合肥兆芯已逐步減少銷售活動，目前僅銷售現有存貨。根據我們對合肥兆芯現有庫存及市場需求的評估，我們預期合肥兆芯將於2026年底停止其銷售活動。

實體清單指定本身並不限制被列入清單的實體向外部人士銷售產品。在進行存貨銷售時，合肥兆芯遵循相關出口管制合規指引，對客戶及目的地國家／地區進行篩查，以確保遵守適用的貿易管制規定，且合肥兆芯要求客戶簽署合規承諾，包括承諾最終用戶並非實體清單相關方。自被列入清單後，合肥兆芯並未採購任何受《出口管理條例》規限的物項。由於實體清單指定並不延伸至被列入清單實體的母公司或聯屬公司，本集團其他成員公司已採購若干受《出口管理條例》規限的物項，而該等採購無須取得BIS許可證。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並無進行任何違反美國出口管制規定的交易。

對本集團其他成員公司的適用性、指定後的轉讓／調整及不構成規避／違規的依據

於往績記錄期間，合肥兆芯的收入貢獻對本集團而言仍屬不重大。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，合肥兆芯的收入貢獻分別約佔我們總收入的3.0%、0.2%、0.1%及不足0.1%。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，合肥兆芯分別擁有約155名、22名、14名及9名員工，分別佔本集團於相關年度員工總數的約19.8%、1.9%、1.0%及0.6%。

BIS對合肥兆芯施加的限制並不適用於本集團的其他成員公司。根據BIS的常見問題解答，BIS已明確表示，實體因被列入實體清單而承擔的許可責任及其他義務本身並不適用於其附屬公

業 務

司、母公司、姊妹公司或其他在法律上獨立且未被列入實體清單的關聯公司，只要該非列入清單的外國聯屬公司不符合關聯規則的標準。然而，倘該公司（甚至非關聯公司）充當清單實體的代理人、前線公司或空殼公司，以促成原本不會被允許與清單實體進行的交易，則該公司很可能違反（其中包括）第十項一般禁令、《出口管理條例》第764.2(b)條（導致、協助或教唆違規），並可能同時違反第764.2條的其他規定。」BIS常見問題解答中所指的「關聯規則」是指BIS於2025年9月29日發佈的「擴展最終用戶管制至特定列名實體的關聯方」規則，該規則將實體清單及軍事最終用戶清單項下的出口管制限制及許可要求擴展至一個或多個列名方擁有50%或以上所有權的外國實體。於2025年11月1日，美國政府宣佈，美國將自2025年11月10日起暫停執行該關聯規則，為期一年。此外，自合肥兆芯被列入清單以來，本集團其他成員公司均未被列入實體清單。就關聯規則的適用而言，倘美國政府於2026年11月10日之後恢復實施，合肥兆芯的全資附屬公司合肥億超將須遵守實體清單許可規定。儘管如此，即使合肥億超須遵守實體清單許可規定，鑒於合肥億超對我們的貢獻有限，我們預期這不會對我們的業務營運造成重大不利影響。於往績記錄期間，合肥億超僅於2025年產生收入，佔我們該年度總收入不足0.001%。基於上述情況，並鑒於本集團其他成員公司作為法律上獨立的實體運營，且並無充當合肥兆芯的代理人、前線公司或空殼公司，我們的國際制裁法律顧問認為，合肥兆芯被列入實體清單一事並不延伸至本集團的其他成員公司（如若關聯規則日後恢復實施，則合肥億超將須遵守實體清單許可規定），因此不會限制本集團其他成員公司（合肥億超除外）採購、獲取或以其他方式取得受《出口管理條例》規限物項的能力。自合肥兆芯被列入清單以來，本集團其他成員公司均未被列入實體清單。我們向美國供應商採購存儲晶圓、電子設計自動化工具及其他相關物項並未受到影響。

截至最後實際可行日期，就本集團除合肥兆芯以外的所有成員主體而言，其各自的投資者、客戶及供應商，均未因實體清單列名事宜撤回對本集團的投資、終止與本集團的業務合作，亦未以書面或其他形式告知我方其存在上述意向。被列入清單後，合肥兆芯的業務運營受到限制，主要由於供應鏈中斷及市場准入受限，因此合肥兆芯無法再維持其原有的業務規模或員工人數。為妥善保障我們員工的合法權益、履行我們的社會責任，並最大程度地保全資產價值，本集團進行了內部戰略規劃，據此將合肥兆芯的若干人員及資產重新分配至本集團其他實體。根據《出口管理條例》第764.2(h)條，「任何人不得從事任何意圖規避《出口管理條例》規定的交易或採取任何其他行動」。將合肥兆芯的若干人員及資產重新分配至本集團其他實體，並不意在亦不會產生規避美國出口管制限制的效果。首先，由於本集團（包括合肥兆芯）自成立以來從未與Huawei或Hikvision進行任何業務交易，無論在被列入清單之前或之後，合肥兆芯被重新分配的人員及資產均未與Huawei或Hikvision進行任何業務活動，亦未進行任何其他違反《出口管理條例》的活動。其次，經過該等調整後，其他集團實體並無充當合肥兆芯的「代理人、前線公司或空殼公司」，以透過促成《出口管理條例》所禁止的交易來規避美國出口管制限制。此外，轉讓合肥兆芯的該等人員及資產是基於合法的商業考慮，包括僱員保障及資產保全，並非為避免適用《出口管理條例》項下的禁令而進行。基於該等原因，我們的國際制裁法律顧問認為，該等調整並無違反實體清單限制。我們亦已委聘外部法律顧問對該等調整後的持續運營進行評估，以確保運營合法合規。

業 務

內部控制及緩解措施

我們已委任外聘法律顧問就該指定進行全面風險評估，並於2023年1月制定業務調整及運營剝離計劃。我們將繼續委任外聘法律顧問及顧問，以審閱我們的出口管制合規計劃並提供意見。此外，BIS常見問題解答所引述的BIS指引顯示，若母公司充當清單實體的代理人、前線公司或空殼公司，以促成在其他情況下不會被允許與清單實體進行的交易，則可能違反《出口管理條例》。被列入實體清單後，我們並無參與任何可能導致違反《出口管理條例》的任何交易。我們並無將任何受《出口管理條例》限制的物品向合肥兆芯轉讓，亦無作為合肥兆芯的代理人、前線公司或空殼公司，以促成任何原本不可進行的交易。我們亦已確保採購活動完全剝離，包括避免本集團任何其他成員公司協助合肥兆芯採購任何項目。

為維持合肥兆芯與本集團其他成員公司之間的運營獨立性，並緩解合規風險，我們已實施全面的運營隔防火牆，包括：

- **研發剝離。**我們已將所有研發人員（不論在調離之前或之後，該等人員均未參與任何與Huawei或Hikvision有關的研發活動或任何交易）從合肥兆芯調離，合肥兆芯僅保留少量售後支持人員；我們與合肥兆芯中止所有研發相關的溝通及合作；
- **採購剝離。**我們已完全剝離採購活動，並禁止本集團任何其他成員公司協助合肥兆芯採購任何物品；
- **存貨剝離。**我們為合肥兆芯設立獨立倉庫，與本集團其他成員公司運營的倉庫在物理上分隔，避免帶有合肥兆芯商標的貨品與本集團其他存貨混存；
- **銷售剝離。**我們已終止與合肥兆芯在銷售相關活動中的所有合作，包括聯合客戶開發及銷售帶有合肥兆芯商標的產品；
- **人員／職務剝離。**我們禁止任何員工同時在合肥兆芯及本集團其他成員公司兼任職務，並確保本集團其他成員公司人員不直接支持合肥兆芯；及
- **IT系統剝離。**我們已調整ERP及OA系統，撤銷所有跨實體訪問權限，並切斷合肥兆芯與本集團其他成員公司之間任何潛在的技術交互。

我們已實施內部控制措施，以確保我們與客戶及供應商的交易符合相關制裁及出口管制法律法規。我們已建立出口管制合規管理體系，該體系包括一項整體政策及部門層面的合規指引，涵蓋（其中包括）我們的採購中心、外包製造及測試職能、營銷中心、研發、人力資源及投資職能。尤其是，我們的採購中心合規指引規定，我們須向供應商取得有關擬採購物項是否受《出口管理條例》規管的資料、保存詳細記錄，並透過合規條款及／或合規聲明確保採購合規。我們的營銷

業 務

中心合規指引規定，在開展銷售活動前，須識別相關交易是否涉及(1)受貿易管制的國家／地區；(2)貿易黑名單人士；及(3)被禁止的最終用途，並要求根據篩查結果實施相應合規措施，包括要求代理商及客戶簽署標準出口管制合規條款及承諾。此外，我們對相關制裁及受限制人士名單進行持續監控，並實施定期重新篩查(以及因交易對手、付運目的地、最終用途／最終用戶資料變動或適用名單更新而觸發的事件驅動重新篩查)，以助及時識別新被指定或經更新的受制裁／受限制目標，我們亦制定了上報程序，以在發現潛在匹配或風險提升時暫停或中止交易，以待加強審查。其他部門的指引亦就相關業務場景載明合規行動，構成全面且多層次的合規框架。我們的董事認為，我們的出口管制合規政策及程序充足有效，能夠識別及緩解因實體清單指定而產生的任何重大風險。基於上述情況，以及獨家保薦人進行的獨立盡職調查工作(包括但不限於其審閱本集團國際制裁法律顧問的評估及依據、本集團的合規及內部控制政策，以及對本集團及其主要客戶、供應商、分銷商及終端客戶進行的背景調查及盡職調查)，獨家保薦人並無注意到任何會使其對董事的上述觀點產生合理懷疑的事項。

儘管有上述合規措施，但由於我們的銷售模式及下游供應鏈的性質，在產品銷售給直接客戶或分銷商後，我們通常無法全面了解或控制所有後續再銷售、轉售安排、融入下游產品或最終終端客戶及最終用途，除非我們的客戶或分銷商向我們提供該等資料。儘管我們進行交易對手篩選、在適當情況下獲得出口管制合規承諾並就涉及高風險的交易實施上報程序，概不保證我們的下游客戶或彼等客戶不會向受貿易限制、制裁或出口管制限制的各方(包括實體名單上的各方)轉售、轉讓、整合或以其他方式提供我們的產品或整合我們產品的產品，或用於受限制的最終用途。任何此類再銷售或轉讓可能會使我們面臨出口管制或制裁相關的問詢、監管機構、供應商或客戶的加強審查、聲譽受損、額外合規成本或客戶或供應商關係中斷。

結 論

根據我們及我們的國際制裁法律顧問所作評估，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的業務活動應不涉及任何重大出口管制或制裁風險。

- 現時美國出口管制對我們業務的影響整體有限且屬可管理，原因是我們的產品不受《出口管理條例》規限，且於往績記錄期間我們並未向任何受限制方名單(如實體清單)上的任何受限最終用戶提供任何受《出口管理條例》規限的物項。
- 根據我們及國際制裁法律顧問所進行的評估，董事認為，合肥兆芯獲列入實體清單並未且不會對我們的供應鏈、業務運營、財務表現、研發能力以及產品及服務組合造成重大影響，原因是(1)對合肥兆芯施加的限制不適用於本集團其他成員公司(如若關聯規則日後恢復實施，則合肥億超(其對本集團的貢獻微不足道)將須遵守實體清單許可規定)，(2)本集團其他成員公司並未進行涉及合肥兆芯且可能違反《出口管理條例》的交易，(3)按收入貢獻計算，合肥兆芯均僅佔我們業務的不重大部分，及(4)我們於其被

業 務

列入清單後已採取緩解措施，確保遵守出口管制法律。基於上文所述，獨家保薦人並未知悉任何可能使獨家保薦人對董事觀點產生合理懷疑的事宜。

- 現時美國制裁對我們業務的影響亦屬有限及可管理，原因是我們並未從事任何一級制裁活動或二級制裁活動，且我們並非受制裁目標，並非於受制裁國家註冊成立、設立或運營，亦非與受制裁目標或受制裁國家實體或個人開展重大部分（10%或以上）業務的被制裁交易方。

質量管理

質量控制及保證對我們的業務至關重要。我們擁有全面的質量管理體系，涵蓋業務的各個方面，包括研發、採購及生產，確保符合相關監管規定及嚴格的內部質量標準。在產品研發階段，我們的質檢團隊對產品設計及研發計劃進行嚴格審查。在採購方面，我們精心挑選並定期審查供應商，並在貨物入庫前進行徹底檢查。此外，我們對外包產品實施嚴格的質量控制流程，包括：(i)進行小批量試產並對樣本進行測試及驗證，以確定是否適合量產；(ii)在量產期間密切監控產品質量，並在發現偏離試產結果時及時調整；及(iii)對製成品進行抽樣檢驗。所有程序及文件均嚴格遵循我們內部標準，以確保產品質量、監管合規及有效第三方製造商管理。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未因重大產品質量問題而收到相關主管部門的任何罰款、產品召回令或其他處罰。

倉儲、物流及存貨管理

我們主要於香港及深圳經營多個倉庫以儲存原材料、在製品及製成品。通過質量檢驗的製成品由物流服務供應商從我們自身倉庫交付予客戶或指定倉庫。我們根據聲譽、經營規模、往績記錄及價格選擇物流服務供應商。我們通常與物流服務供應商訂立長期協議。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因物流服務供應商延遲交付或不當處理產品而導致產品交付出現任何重大中斷或蒙受任何損失。截至2023年12月31日、2024年12月31日、2025年12月31日以及2026年4月30日，我們的存貨結餘分別為人民幣2,548.2百萬元、人民幣3,949.8百萬元、人民幣7,172.3百萬元及人民幣10,886.9百萬元。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四個月，我們的存貨週轉天數分別為101天、162天、231天及356天。我們的存貨週轉天數由2023年的101天增至2024年的162天，主要由於我們主動增加存貨以滿足主要客戶的預期需求。我們的存貨週轉天數由2024年的162天進一步增加至2025年的231天，原因為我們策略性地增加存貨水平，以應對存儲產品平均售價的大幅上漲。我們的存貨週轉天數由2025年的231天增至截至2026年4月30日止四個月的356天，主要由於我們積極積累存貨以滿足主要客戶的預期需求。

為維持我們的競爭地位及使我們的產品符合不斷變化的市場需求，我們已實施多項措施以優化存貨水平。該等措施包括最大限度地減少存貨積壓及加強存貨管理流程。我們已建立提交

業 務

及批准的內部程序，以簡化物流及標準化我們產品的採購訂單。我們採用ERP軟件跟蹤存貨水平，確保原材料及製成品維持在適當水平，並實時監控倉庫中貨物的流入和流出。我們每三個月進行一次全面的存貨檢查，以確保倉庫的高效運作。董事確認，我們的存貨控制系統及政策始終有效，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無出現重大供應短缺或存貨積壓問題。

知識產權

知識產權對保障我們的業務至關重要。我們通過專利、商業秘密、專有技術、商標、版權、反不正當競爭法律及合同權利(如保密協議)相結合的方式保護我們的知識產權。我們未來的商業成功，部分取決於我們能否就與業務相關且具商業重要性的技術、發明及專有技術取得並維持專利及其他知識產權與專有保護，捍衛及執行我們的專利，保持我們商業秘密的機密性，以及在未侵犯、盜用或以其他方式侵害外部各方知識產權的前提下經營業務。

截至2026年4月30日，我們在中國及海外擁有416項授權專利，其中包括320項發明專利。截至2026年4月30日，我們在中國及海外擁有74項版權及35項註冊商標。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未涉及任何對我們產生重大不利影響的知識產權侵權糾紛或索賠。請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業相關的風險 — 如果第三方聲稱我們侵犯他們的知識產權，我們可能會承擔相應的責任和罰款，並可能不得不重新設計或暫停銷售相關產品」。

於2024年1月，我們收到第三方(「企業X」)發出的函件，內容涉及企業X聲稱為與若干存儲相關標準相關的標準必要專利(「SEP」)的專利許可組合。企業X表達願意按公平、合理及無歧視(「FRAND」)原則與我們進行磋商。我們回覆企業X，表示願意進行此類磋商。截至最後實際可行日期，企業X與我們仍在按照FRAND原則持續進行善意磋商。詳情請參閱「風險因素 — 與我們業務及行業有關的風險 — 潛在的知識產權談判及糾紛，包括涉及標準必要專利的談判及糾紛，可能曠日持久，並可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響」。

知識產權風險管理措施及合規機制

我們已建立一套涵蓋研發、專利申請及組合管理、外部合作、商業化前審查、爭議上報及持續監控的全面內部控制及知識產權合規框架。主要控制措施包括：(1)全面內部控制架構 — 我們已採納內部政策及操作程序，規管知識產權相關事宜的識別、評估、審查、上報及處理，並明確劃分知識產權、研發、銷售、採購、品牌及法律／合規職能部門的責任。尤其是，我們的知識產權部門為專利、商標、版權及技術相關事宜的中央協調職能部門；我們的研發團隊負責及時報告發明、技術成果及擬對外進行的技術披露；我們的銷售、採購及品牌職能部門負責就面向客戶、面向供應商及宣傳相關活動啟動相關知識產權審查程序；我們的法律／合規職能部門則協調合同保護、爭議處理及外部法律支持。我們亦已建立內部審批、上報及匯報程序，據此，重大或潛在爭議性的知識產權事宜將及時向高級管理層匯報，並在適當情況下轉交專業外部顧問作進一步評估及回應；(2)事前風險識別 — 在研發項目立項階段，我們的知識產權部門會進行專利及技術檢索，並在適當情況下申請知識產權保護。就對外合作項目而言，我們亦會就知識產權歸屬及相關利益分配訂立書面安排；(3)定期風險排查 — 我們的知識產權部門定期編製知識產權風險識別登記冊並發送予相關部門。各部門其後進行風險識別，按照內部審批程序更新登記冊，並跟進緩解措施；(4)關鍵商業化節點的把關 — 在產品銷售或營銷及宣傳活動之前，相關業務團隊必須完成知識產權審查程序，我們的知識產權部門會審查相關技術、商標及版權的法

業 務

律狀況及授權情況；(5)事件應對及補救措施 — 當出現潛在或實際的知識產權相關風險事件時，我們會啟動跨職能應對機制。我們已進一步加強應對流程，包括委聘專業外部知識產權法律顧問、集中處理標準必要專利相關的溝通及談判，以及加強標準相關產品的內部記錄保存及跨職能審查；及(6)專利保護及組合管理 — 我們高度重視專利保護，並已建立龐大的專利組合。我們已制定專利資產全生命週期管理的程序，包括發明披露、專利性及商業相關性的內部評估、申請策略、審查、維持、年費支付追蹤及定期組合審查。我們的知識產權部門與研發團隊緊密合作，於產品及技術開發的各個階段識別可申請專利的成果，並根據相關發明的技術重要性、商業應用及防禦價值，逐案釐定適當的保護策略。我們亦會定期檢討及優化我們的專利組合，以支持關鍵技術及產品線，使專利保護優先次序與我們的業務發展及研發方向保持一致，並加強我們對抗第三方知識產權風險的防禦地位。截至2026年4月30日，我們持有320項發明專利，此舉同時支持產品開發及防禦性風險管理。我們的內部控制顧問已審閱上述內部控制措施的設計及執行情況，並認為該等措施足以有效應對知識產權相關合規風險。

信息安全與數據私隱

我們認為數據的保密性、完整性及可用性對於我們的業務運營至關重要。由於我們的交易僅面向企業客戶，故我們的業務不涉及收集或處理個人客戶的信息。儘管如此，我們在運營過程中仍會收集、存儲及處理業務與交易數據，此等活動須遵守不斷演變的法規要求並接受行政監督。

在日常業務運營中，我們僅產生及處理內部研發及運營數據，並無進行任何外部數據收集活動。所有該等內部數據均存儲於我們運營所在內的合規設施。此外，於往績記錄期間，我們並無進行任何跨境數據傳輸。我們並非《網絡安全審查辦法》所界定的網絡平台運營者或關鍵信息基礎設施運營者。經審慎檢討我們的信息安全政策、內部管理制度、實際運營狀況、重大合同、合規證明及其他相關資料，我們的中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已就適用於我們業務運營的數據安全及個人信息保護建立並實施相應的內部管理制度。我們並無發生與數據安全或個人信息保護的相關的任何重大違規，亦無因數據合規事宜遭受相關監管機構的任何處罰、調查或投訴。因此，我們的業務運營在所有重大方面均一直符合《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》及其他適用法律、法規、規則及監管文件的規定。

業 務

我們已建立涵蓋業務運營多個階段的全面信息安全管理框架：

- **網絡安全。**為保障網絡基礎設施，我們實施多層次安全措施，包括防火牆、入侵檢測系統及終端安全系統。我們的網絡設計具備冗餘特性，以確保持續安全的信息流。我們定期進行漏洞評估及滲透測試，以主動識別並緩解潛在威脅。
- **數據保護與私隱。**我們通過包含加密、安全訪問控制及定期備份在內的綜合數據管理系統，優先保護敏感數據。對關鍵信息的訪問按角色權限限制，並僅獲授權人員可處理或查閱敏感數據。
- **安全審計與持續監控。**我們持續監控我們的IT系統是否存在漏洞及潛在威脅，包括定期安全審計、實時監控及性能測試。我們會透過糾正措施及時處理任何識別出的弱項，並定期舉行安全演練以測試應對能力。
- **災難恢復與業務連續性。**我們已制定並持續更新災難恢復計劃，以確保關鍵IT系統在發生中斷時可快速恢復。我們會對IT基礎設施每日進行健康檢查，並定期測試備份以確保數據完整性。
- **員工意識與培訓。**我們定期舉辦培訓，以確保所有員工了解其在數據安全方面的責任。員工亦須簽署保密協議，以保護知識產權及公司敏感信息。

信息技術系統

我們的信息技術系統對於提升運營效率、保障數據安全及維持業務連續性不可或缺。我們已開發與自身組織架構、業務範圍及技術能力相匹配的綜合IT基礎設施。為確保可靠性、安全性及效率，我們持續完善IT管理政策、規範軟件與服務器管理，並實施嚴格訪問控制措施。我們定期進行系統更新、數據備份及網絡安全檢查，以提升系統穩定性並預防潛在中斷。我們的核心信息技術系統包括：

- **ERP系統：**我們的ERP系統整合財務、供應鏈及客戶管理至統一平台，以實現運營流程化及數據實時一致性。
- **JIRA系統：**我們的JIRA系統追蹤研發項目進度，以實現產品開發全流程的高效任務分配、問題跟蹤及跨團隊協作。
- **SHR系統：**我們的SHR系統管理員工信息及組織信息，以實現高效人力資源管理。

於往績記錄期間直至最後實際可行日期，我們未曾遭遇任何對我們的業務運營造成重大不利影響的重大IT系統故障或停機事件。

業 務

競爭

全球存儲產品行業市場空間龐大。2025年全球存儲產品市場規模達2,890億美元。市場規模預計將由2026年的3,775億美元持續增長至2030年的7,238億美元，期間年複合增長率為17.7%。我們主要與全球及本地獨立存儲器廠商競爭。我們市場的主要競爭因素包括技術專業知識及創新研發能力、產品開發能力及供應鏈合作關係。更多詳情請參閱「行業概覽」。

員工

截至2026年4月30日，我們大部分員工位於中國內地。下表載列截至2026年4月30日按職能劃分的員工明細：

職能	數量	佔總數百分比 (%)
研發.....	867	62.5
行政.....	195	14.0
製造.....	173	12.5
銷售及營銷.....	152	11.0
總計.....	1,387	100.0

招聘

我們通過校園招聘、在線招聘及獵頭公司招聘新員工。此外，我們高度重視推薦及內部晉升機會，相信此舉有助留住熟悉業務模式並認同企業價值的員工，對實現可持續發展至關重要。我們與全體員工簽訂僱傭合同，並與所有員工訂立保密協議。我們與員工訂立的僱傭合同載列僱用期、薪酬、社會保險及勞動保護。

我們未遭遇任何對我們的業務運營造成或可能造成不利影響的重大勞資糾紛。我們認為已與員工保持良好關係，且於往績記錄期間與之並無重大勞資糾紛。

激勵

我們提供具競爭力的薪酬福利，以吸引及留住優秀人才。除薪酬及福利外，優秀員工可參與股權激勵計劃。此外，我們定期進行績效評估，並根據績效及能力給予晉升與調薪，以獎勵表現優異及具潛質的員工。

培訓

我們已實施完善的培訓政策，致力促進員工持續發展與成長。根據該政策，我們每年舉辦各類培訓課程，涵蓋管理與領導技巧、技術進階、業務拓展及法律法規合規等領域。此等培訓由兼具內部經驗與外部專長的講師團隊共同授課，既包括擁有本集團豐富經驗及知識的內部講師，

業 務

亦邀請帶來外部專業知識及行業最佳實踐的第三方顧問。通過多元培訓機會，我們旨在提升員工技能與能力，從而確保其持續適應行業需求變化，並為我們的業務發展作出有效貢獻。

保險

我們購買多項保險以覆蓋業務各環節，包括財產設備損壞險、綜合財產險、物流險及貿易信用險，以保障業務連續性。根據弗若斯特沙利文的資料，我們的承保範圍符合行業慣例。我們定期審閱保單以確保符合法定要求。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未遭遇任何重大保險索償。然而，我們仍可能面臨超出保險承保範圍的潛在索償與負債。更多詳情，請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業相關的風險 — 我們的保險承保可能不足以覆蓋客戶的所有損失或潛在索賠，這將影響我們的業務、財務狀況和經營業績」。

物業

租賃物業

截至最後實際可行日期，我們在中國合共租賃21項重要物業，總建築面積約42,013平方米，主要用作研發設施、倉庫及辦公室。我們通常可提前通知終止租約，此舉為我們提供運營靈活性。我們認為中國內地物業供應充足，且我們的業務運營不依賴現有租賃。我們相信，我們的現有設施足以滿足當前需求。然而，隨著我們業務的持續擴張，我們可能需要購買及租賃更多物業或設施以支持未來的增長。

物業估值

截至最後實際可行日期，本集團物業業務所涉的各項物業權益中，概無任何一項的賬面值達到本集團總資產的1%或以上我們未持有任何賬面值達總資產15%或以上的單一物業；因此，根據上市規則第5.01A條，本文件無須附載任何估值報告。根據《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第6(2)條，本文件獲豁免遵從《公司(清盤及雜項條文)條例》第342(1)(b)條連同該條例附表三第34(2)段有關就我們所有土地或樓宇權益提供估值報告的規定。

環境、社會及管治

ESG管治

ESG管理與戰略

公司將可持續發展理念融入戰略與運營管理，並已構建職責清晰、有效執行的ESG治理體系。董事會作為ESG事務的最高決策機構，負責制定戰略方向與目標，及審議年度計劃與績效表現，

業 務

確保與長期戰略保持一致。戰略與ESG委員會透過監督戰略執行、風險識別及披露事宜，並設跨部門工作機制涵蓋人力資源、行政、法務、採購及財務，實現協同管理。

公司堅持「實質性」原則，評估ESG事項的影響及財務重要性，將結果納入經營規劃與風險管理。我們聚焦氣候變化、能源管理、員工發展及供應鏈責任，通過目標設定與績效跟蹤推動落實，並每年開展績效評估及外部審查，持續提升我們的管理體系。

綠色共贏

環境管理及目標

公司堅持綠色可持續發展理念，嚴格遵守國家及地方政府所規定的相關法律法規，持續完善內部環境管理體系，構建制度完善、責任明確的環境管理框架。公司已通過ISO 14001環境管理體系認證，覆蓋生產、運營及辦公環節，確保環境管理科學、規範、可持續。

在能源使用管理方面，公司將能源管理納入日常運營，通過系統性監測及設備優化提升能源效率。在水資源管理方面，我們定期監測取水、用水及廢水排放數據，通過產業園區的廢水處理系統確保合規排放。在廢棄物管理方面，公司依據《噪音與「三廢」管理辦法》(Noise and 「Three Wastes」Management Measures)對一般及危險廢棄物實行分類管理，確保由合資格實體規範處置，並保持100%的合規處置率。在氣候變化管理方面，我們定期進行溫室氣體核算，加強碳排放數據監測與分析，推廣節能設備及綠色能源使用，推進運營低碳轉型。

以2025年為基準年，公司制定了階段性環境績效目標：到2026年，綜合能耗強度較2025年下降2%，人均用水量下降3%，溫室氣體排放強度下降2%，並持續保持廢棄物合規處置率100%及污染物穩定達標排放。

應對氣候變化

氣候變化已成為全球經濟與產業發展的共同挑戰。公司積極響應國家「雙碳」戰略與全球氣候治理倡議，將低碳理念融入戰略管理與業務運營全過程。我們深刻認識到氣候變化對可持續發展的重要影響，持續推進節能降耗、綠色生產與供應鏈減碳，通過技術創新與管理優化，增強氣候韌性與綠色競爭力。

在治理層面，公司建立系統的氣候變化管理機制，將相關議題納入環境與風險管理體系。董事會ESG委員會負責統籌戰略方向與執行監督，管理層制定並落實應對措施，各職能部門具體執行，形成自上而下、職責明晰的管理架構。

業 務

在風險與機遇管理方面，公司定期識別和評估氣候變化對經營的潛在影響，並根據風險性質分類制定相應的應對措施：

風險類型	風險事件	風險等級	時間範圍	潛在影響	應對措施
物理風險	颱風、暴雨等 極端天氣；	低	短	1. 公司辦公場所、研發中心或生產基地的物理安全與正常運轉； 2. 電力供應中斷(半導體製造與研發對電力穩定性要求極高)； 3. 物流中斷，影響原材料運輸或成品交付。	與供應鏈合作夥伴協同，建立多區域、多渠道物流備份機制，降低極端天氣對供應鏈的衝擊； 加強數據中心、研發實驗室、辦公區域的防洪、防颱風、防高溫設施建設。
轉型風險	政策與法規風險	中	長	1. 中國及全球各司法管轄區正逐步加強對電子產品全生命週期碳排放、能效標準、回收要求的監管； 2. 未來可能對存儲產品的功耗、能效、綠色設計、包裝材料等提出更高要求。	將氣候變化納入公司戰略與風險管理，設立ESG委員會；密切關注國際標準，提前佈局合規應對； 加強員工氣候變化與ESG培訓，提升組織整體的氣候認知與適應能力。
	技術創新 風險	低	長	未來存儲產品行業可能向更低功耗、先進制程節點、更環保材料方向演進，若未能及時跟上節能芯片設計及低功耗存儲解決方案的發展步伐，我們可能在技術競爭與市場定位中落後。	研發低功耗、高能效存儲產品，滿足智能設備、物聯網對節能的需求； 與上下游合作夥伴合作，共建綠色供應鏈，推動供應商減排與低碳物流。

業 務

同時，在氣候變化所帶來的潛在機遇角度來看，我們也識別了多個層面的主要機遇：

機遇	機遇概述	潛在影響	應對措施
綠色供應鏈與客戶.....	滿足下游綠色採購需求	1. 成為綠色供應鏈認證供應商，進入國際頭部客戶及車規級供應鏈； 2. 獲得更多來自注重ESG的品牌客戶訂單，擴大市場份額。	建立產品碳足跡評估能力，逐步披露關鍵芯片的碳足跡；優化芯片封裝、材料選擇，減少有害物質與環境負擔；主動與客戶溝通ESG目標，提供綠色產品解決方案與數據支持。
市場與品牌	提升ESG形象，吸引綠色投資與人才	1. 提升公司在資本市場中的吸引力，有助於未來融資、上市估值或獲得綠色信貸； 2. 增強品牌公信力與社會責任形象，尤其是在國際市場； 3. 吸引注重可持續發展的優秀工程師、管理人才與合作夥伴。	定期發佈ESG報告或氣候相關披露，展示公司在應對氣候變化方面的努力；參與ESG評級，並持續優化評分；在辦公文化中融入ESG理念，如綠色辦公實踐、公益活動、員工ESG教育；通過媒體、行業論壇等渠道，傳播公司在節能芯片、低碳創新方面的實踐。
政策與激勵	享受政府綠色科技與半導體扶持政策	1. 降低研發與運營成本，提升資金使用效率； 2. 獲得政策扶持與榮譽資質； 3. 在地方產業政策中佔據有利地位，助力擴張與融資。	積極申報國家及地方綠色科技項目、半導體專項、低碳創新基金；與政府、行業協會合作，參與制定存儲產品的綠色標準與行業規範。

在溫室氣體排放管理方面，公司為落實應對氣候變化戰略，依據中國生態環境部發佈的《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南——發電設施(2021年修訂版)》、政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發佈的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》以及《溫室氣體核算體系》所載的標準，系統建立了溫室氣體清單與管理體系。公司溫室氣體核算範圍覆蓋範圍一範圍二及範圍三排放，涵蓋生產製造、原材料採購、倉儲物流及日常辦公運營，確保排放數據的完整性、準確性與可追溯性。

業 務

於2025年，公司溫室氣體排放總量為53,206噸二氧化碳當量，其中範圍一直接排放為8.3噸，範圍二間接排放為3,686.8噸，範圍三其他間接排放為49,511.0噸。溫室氣體排放強度為每百萬營收4.7噸二氧化碳當量。基於此，公司以2025年為基準年，制定了階段性減排目標：

- 到2027年，溫室氣體總排放強度較基準年下降2%；
- 到2030年，累計降幅達到10%。

	截至12月31日止年度			截至4月30日 止四個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
溫室氣體排放總量(噸二氧化碳當量)	50,920.1	43,423.3	53,206.1	36,815.4
範圍一—直接溫室氣體排放(噸二氧化碳當量).....	10.0	7.4	8.3	3.3
範圍二—間接溫室氣體排放(噸二氧化碳當量).....	1,672.1	2,214.0	3,686.8	1,121.5
範圍三—其他間接溫室氣體排放(噸二氧化碳當量)	49,238.0	41,201.9	49,511.0	35,690.6
溫室氣體總排放強度(噸二氧化碳當量／百萬營收)	5.8	5.0	4.7	4.6

污 染 物 與 廢 棄 物 治 理

公司高度重視廢棄物的合規及系統化管理，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及其他適用法律法規，且已建立覆蓋生產、辦公及倉儲活動等環節的分類、收集、存儲與處置的廢棄物管理框架。公司運營過程中產生的所有廢棄物、污染物及材料，均透過產業園區的集中污染防治、廢棄物處理及材料回收系統統一管理。在此框架內，委託合資格第三方機構安全轉運危險廢棄物並進行無害化處置，確保全流程合規可追溯。在執行層面，公司堅持綠色製造、合規處置、源頭控制及資源循環的原則，確保符合國家及地方環保標準。展望未來，公司將持續優化我們的廢棄物管理體系，加強員工培訓，保持廢棄物合規處置率100%，支撐綠色可持續運營。

資 源 管 理

公司嚴格遵守國家及地方的適用法律法規，系統推進能源與水資源管理，以提升資源利用效率，推動可持續運營。在能源管理方面，公司已建立能源消耗台賬與監測機制，制定年度節能目標，並將此目標納入績效評估，以推動運營層面的能效提升。2025年，公司的能源消耗總

業 務

量為1,680.6噸標準煤，能源消耗強度為每人民幣億元營收0.1噸標準煤。以2025年為基準年，公司設定到2026年能源消耗強度下降3%的目標，並將透過提升設備能效、改造照明系統及優化空調運行等措施，降低整體能耗。

在水資源管理方面，公司加強用水管理以提升利用效率。2025年，公司的用水總量為10,629.2立方米，用水強度為每百萬元人民幣收入用水1.0立方米。以2025年為基準年，公司計劃到2026年使每百萬元人民幣收入的用水量減少3%，同時持續維持100%的廢水達標排放率。

於往績記錄期間，我們的能源消耗強度保持穩定，於2023年、2024年及2025年分別為每百萬元人民幣收入使用0.1噸標準煤，顯示能源消耗強度並無重大波動。能源消耗總量增加主要歸因於我們的業務及生產規模擴張、生產、測試、辦公及研發場所的使用率提高，以及日常運營活動相應增加。我們的用水強度維持在相對較低水平，且並無經歷任何重大波動，於2023年、2024年及2025年分別為每百萬元人民幣收入用水0.6立方米、0.9立方米及1.0立方米。用水強度的變化主要歸因於業務規模擴張、員工人數增加以及生產、測試、辦公及研發場所使用率提高所導致的日常運營及輔助用水量增加。根據弗若斯特沙利文的資料，我們的用水強度處於行業正常範圍內。

	截至12月31日止年度			截至4月30日 止四個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
水資源消耗總量(立方米)	4,950.0	7,571.3	10,629.2	3,069.6
能源消耗總量(噸標準煤)	756.1	995.5	1,680.6	511.6
水資源消耗強度(立方米／每百萬元人民幣收入)	0.6	0.9	1.0	0.4
能源消耗強度(噸標準煤／每百萬元人民幣收入)	0.1	0.1	0.1	0.1

共 贏 共 創

產品服務安全與質量

公司始終將產品質量與信息安全視為可持續發展的核心基礎，建立覆蓋研發、採購、生產、交付及售後服務全過程的質量與數據管理體系。我們遵循國際公認的ISO 9001及ISO 26262質量管理及功能安全標準等國際公認標準，並定期接受第三方審計，確保體系高效運營。

公司在PMC體系下實施全生命週期質量控制，明確各階段的責任及標準。關鍵工序均設有自動化檢測點，製成品須通過測試，不良率控制在≤0.003。公司對關鍵供應商實行分級管理與審計，要求其提供RoHS及REACH等認證。公司已建立標準化服務流程與SLA機制，設有24小時服

業 務

務熱線及線上渠道，一般投訴於24小時內響應、5個工作日內結案，重大質量問題則於1小時內上報質量委員會。截至2026年4月30日，公司未發生因產品安全或質量問題引發的重大客戶投訴、召回或行政處罰。

員工發展

公司將員工視為核心競爭資源並致力構建公平、多元及專業的工作環境。在招聘管理方面，公司堅持平等、多元及非歧視原則，並已制定《招聘管理辦法》及《員工手冊》等政策，確保程序規範公正。依據《童工、未成年工管理辦法》，公司嚴格核驗應聘人員年齡，並禁止使用童工。

在員工權益保障及發展方面，公司嚴格落實法定「五險一金」制度，並提供多元化員工福利。依據《女職工勞動保護管理辦法》，公司為女性員工提供孕期、產期及哺乳期的特殊保護，並吸納了50餘名少數民族員工，以促進工作場所的多樣性。根據《員工投訴與舉報管理制度》，公司已建立多渠道申訴機制，並在一周內完成調查。公司已制定《薪酬管理辦法》及《員工職業發展管理辦法》，維持具市場競爭力的薪酬待遇，對關鍵人才實施以績效為基礎的激勵政策，並提供涵蓋入職、專業發展及年度合規課程的結構化培訓。

職業健康與安全

公司始終將員工健康與安全視為可持續發展的核心基礎，並已建立涵蓋生產安全、職業健康及防災應急的管理體系。依據《職業健康安全和環境管理辦法》，公司實施系統的職業健康管理，為員工（特別是生產與倉儲崗位員工）提供年度健康體檢，並根據檢測結果採取針對性防護措施。公司亦定期檢測工作環境及防護設施，確保達到國家職業健康安全標準。

在安全及應急管理方面，公司依托《關鍵敏感區域管理辦法》《監控設施管理辦法》《應急響應管理辦法》等制度，對生產、倉儲及辦公區域實施分級管控，為重點區域配備門禁及監控系統，並定期巡檢消防設施及應急通道。行政部門每月巡檢消防設施，每年組織至少一次安全培訓。公司已設立應急管理委員會，制定針對火災、地震、停電及傳染病等突發事件的應急預案，並定期開展風險識別與應急演練。截至2026年4月30日，我們並無錄得任何工作相關死亡事故，亦無任何重大意外或工傷。

可持續供應鏈

公司將可持續供應鏈管理納入企業戰略核心。我們以無晶圓廠業務模式運營，不直接參與晶圓製造或封裝活動，僅內部承擔部分測試工作。有關製造流程主要由獨立第三方晶圓製造商及半導體委外封裝測試（「OSAT」）服務供應商承辦。儘管如此，我們知悉上游製造流程屬高能耗

業 務

並可能於供應鏈中產生環境影響。通過機構監督與持續改進，公司在保障供應穩定與質量合規的同時，推動上下游夥伴履行社會與環境責任。

在管理體系方面，公司依據《採購管理辦法》《供應商管理辦法》等制度，建立供應商全生命週期管理機制，涵蓋准入審計、績效評估、監督審計與淘汰退出等環節。准入階段，公司嚴格審查供應商的經營資質、環境管理水平、社會責任履行及質量體系建設，確保合作夥伴符合公司標準與行業規範。在合作過程中，核心供應商須持有國際認可的環境管理體系認證，例如ISO 14001環境管理體系認證。在合作過程中，我們透過定期溝通、文件審查、年度審計及內部評估，持續審查主要供應商的環境合規狀況及可持續發展常規，並將相關環境要求納入合作協議。對存在違規或持續不達標的供應商，啟動風險預警並視情況暫停或終止合作。截至2026年4月30日，公司部分供應商已通過ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環境管理體系認證以及認可經濟運營商(AEO)認證。此外，我們主要與具備先進製造能力及相對更高的能效標準的領先的晶圓製造商與OSAT服務供應商合作。透過持續優化芯片設計、工藝選擇及產品整合，我們致力於提升產品層級能效及(如適用)減少貫穿整個供應鏈的整體環境足跡。展望未來，我們將持續強化供應商ESG管理框架，加強上游合作夥伴監控及合作力。

社區貢獻

我們將社會責任融入公司的長期發展戰略，持續投入於鄉村振興、民生關懷及應急支援。截至2026年4月30日，我們累計捐贈金額達人民幣220,000元，惠及困難群體逾百人次。自2021年起，我們落實對口幫扶廣西南寧上林縣項目，首期捐贈人民幣10,000元並為農產品電商平台的發展提供技術支持。2023年至2025年，我們向澄泰鄉高頂村定向捐贈合共人民幣100,000元，用於道路修繕與基礎設施完善，惠及農戶200餘戶。

憑藉在社會責任領域的表現，我們獲評「福田區愛心企業」等榮譽。展望未來，我們計劃進一步加強公益事業，包括擬設立「鄉村數字振興基金」以支持偏遠地區數字基礎設施建設，並探索將碳普惠機制與公益捐贈相結合，以提升我們公益體系的可持續性及社會價值。

廉潔從業

公司將廉潔從業作為企業治理的核心要求，並嚴格遵守適用法律法規。公司已建立以《反舞弊管理辦法》及《關聯交易管理辦法》等政策為支撐的廉潔從業管理體系。由董事會、審計委員會及管理層組成的三級監督體系，確保權責明確及內部的權利制衡。公司對採購、銷售及招投

業 務

標等重點業務領域實行監督，要求定期開展廉潔自查，並設立涵蓋電話、郵箱及微信等多個匿名舉報通道的舉報管理制度。公司對違規行為採取零容忍態度，一經查實不當行為即追責問責。

在風險防控與宣導方面，公司定期開展廉潔教育及培訓，要求關鍵崗位人員簽署《盡職調查與廉潔從業承諾書》，並將廉潔指標納入績效考核。公司持續強化內部審計與風險評估機制，聚焦高風險業務領域與關鍵崗位，以防範利益輸送、行賄受賄及關聯交易不當等行為。於往績記錄期間，公司經營運行規範有序，內部控制有效，未發生任何與賄賂、腐敗、舞弊或洗錢相關的案件。

內部控制與風險管理

我們已建立全面的風險管理及內部控制體系，旨在識別、評估及緩解運營各環節的風險。董事會負責監督風險管理政策及程序的實施，涵蓋關鍵運營、財務、法律及市場風險，包括信息系統風險、財務報告風險、人力資源風險及反腐敗風險。此等政策構成我們內控框架不可或缺的組成部分，我們會定期檢視其有效性及與戰略目標的一致性。

為提升風險管理能力，我們已實施內控程序，旨在通過結構化風險與機遇分析，系統性識別、評估及排序重大風險(包括ESG相關風險)。此持續進程有助於我們堅持完善風險監督並在全公司培育合規文化。為監測[編纂]後風險管理政策及企業管治措施的持續落實，我們已實施或將繼續推行(其中包括)以下風險管理措施：

- 設立審計委員會以審閱及監督財務報告流程及內控系統。委員會成員資歷及經驗，請參閱「董事、監事及高級管理層」；
- 採納多項政策以確保遵守上市規則，包括但不限於風險管理及關連交易方面；
- 定期為高級管理層及員工提供職業行為要求及道德標準培訓，以加強其對適用法律法規的認知與遵守，並將相關違規處理政策納入員工紀律措施及監督指引；
- 為董事及高級管理層組織關於上市規則要求及香港上市公司董事責任的培訓；
- 強化運營設施的報告及記錄系統，包括統一質量保證及安全管理體系，並定期巡查設施；
- 制定一套應對重大質量問題的應急處理程序；及
- 提供關於質量保證及產品安全程序的強化培訓課程。

業 務

我們已聘請內控顧問審閱我們主要業務流程相關內控的有效性，識別缺陷及改進領域，提供建議並檢視整改措施的落實狀況。我們亦定期檢視內部政策及程序，以降低風險並確保符合監管要求及業務目標。

法律訴訟與合規性

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未捲入任何對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟（包括任何破產或接管程序）。於同期及直至同日，我們未發生任何因重大違規而導致罰款、執法行動或其他處罰（將單獨或合計或會對我們的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響）的事件。

據中國法律顧問告知，我們的業務運營於往績記錄期間及直至最後實際可行日期於所有重大方面均符合適用的中國法律法規。更多詳情，請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業相關的風險 — 我們的業務主要在中國開展，未能適應中國出台的任何影響行業及我們產品終端市場的政策變化可能會對我們的業務產生重大不利影響」。

2024年5月商標侵權事件

2024年5月，我們出口供應商提供的集成電路（「**相關供應商**」）由深圳坪山綜合保稅區至境外區域。在海關檢查過程中，中國海關認定該集成電路侵犯第三方實體的商標權。因此，中國海關就出口該等貨物向我們處以約人民幣120.0千元的罰款，並沒收價值約人民幣2.0百萬元的相關集成電路。相關集成電路乃應客戶要求作為一次性附屬交易的一部分出口至客戶，並不構成我們核心產品供應的一部分。我們對涉案商品的商標侵權行為不存在主觀故意或過失。該交易乃為促進客戶的採購需求而進行，而非作為我們日常業務過程的一部分。我們並無確認該項交易的任何收入。於往績記錄期間，我們並無從事涉及第三方集成電路的類似出口或貿易活動作為經常性業務，因此我們於往績記錄期間的收入概無來自該等活動。我們已停止該等相關活動，且日後不擬從事涉及第三方集成電路或不屬於我們常規產品系列的其他第三方產品的類似出口或貿易活動。

本次侵權事件的直接原因是相關供應商未如實告知我方產品的知識產權缺陷。該事件對我們並無重大不利影響，主要是由於：(i)據我們的中國法律顧問告知，海關施加的處罰並不構成重大處罰，且該事件並不構成嚴重違反適用中國法律及法規；及(ii)鑒於集成電路由我們的供應商提供，且我們事先並不知悉商標侵權，我們已獲相關供應商就我們支付的罰款及被沒收集成電路的價值作出全數彌償。於2025年末，我們已終止與相關供應商的合作。

該事件涉及的商標所有人是一家製造DRAM芯片及快閃存儲芯片的韓國半導體公司。概無就該事件向我們提出任何損害申索，亦無就該事件對我們展開任何訴訟或仲裁程序。我們並無因該事件而錄得任何存貨撇帳。事件發生后，我們對採購、出口及產品清關程序進行內部審查，

業 務

並加強內部控制，以防止類似事件再次發生。這些措施包括(其中包括)：(1)加強第三方產品在出口或交付前的商標和知識產權清關檢查；(2)加強供應商盡職調查及審計程序，包括核實供應商使用相關商標及知識產權的權限；(3)收緊涉及第三方產品的非核心或附屬交易的審批程序；及(4)為相關人員提供知識產權合規及商標使用方面的針對性培訓。我們的內部控制顧問已審查上述措施，並認為在加強后，我們有關知識產權清關及供應商管理的內部控制足以有效應對此事件所識別的風險。

執照、批文及許可證

截至最後實際可行日期，我們已從相關政府部門獲得對我們在中國及海外的業務運營至關重要的所有必要執照、批文及許可證。我們須不時續期該等執照、批文及許可證，並持續監督是否遵守相關法律法規。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在執照、批文及許可證續期方面未遭遇重大困難，且目前預計續期不會出現重大障礙。

下表載列我們截至最後實際可行日期持有的重要執照、許可證及批文的清單。

執照／許可證	持有許可證／ 執照的實體	授予日期	屆滿日期
質量管理體系認證證書	本公司	2019年9月16日	2028年9月15日
海關進出口貨物收發貨人備 案回執	本公司	2018年12月27日	不適用
環境管理體系認證證書	本公司	2022年9月15日	2028年9月14日
職業健康安全管理体系 認證證書	本公司	2022年9月15日	2028年9月14日
信息安全管理體系認證 證書.....	本公司	2020年3月23日	2028年4月10日

業 務

獎項與榮譽

下表載列我們截至最後實際可行日期所獲的主要獎項及認可：

獎項／榮譽	頒獎年份	頒獎機構／部門
廣東省製造業單項冠軍企業 — 嵌入式存儲芯片	2026年	廣東省工業和信息化廳
國家級專精特新「小巨人」企業.....	2025年及2022年	中華人民共和國工業和信息化部
中國獨角獸企業.....	2025年	北京市長城企業戰略研究所
廣東省企業五百強.....	2025年	廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會
廣東省民營企業100強.....	2025年	廣東省工商業聯合會
深圳瞪羚獨角獸企業	2025年	深圳市工業和信息化局
最佳合作夥伴	2025年、2024年及 2023年	小米科技有限責任公司
最佳合作夥伴	2025年	創維集團有限公司
最佳合作夥伴	2025年	上海移遠通信技術股份有限公司
賽迪科創獨角獸百強	2024年	賽迪科創
深圳市企業五百強.....	2024年	深圳市企業聯合會和深圳市企業家協會
傑出合作夥伴	2024年	電子元器件和集成電路國際交易中心
鼎力支持獎	2023年	深圳傳音控股股份有限公司
國家高新技術企業.....	2023年及2020年	深圳市科技創新委員會，深圳市財政委員會和國 家稅務總局深圳市稅務局
最佳供應商	2023年	上海小度技術有限公司